

**2012年(平成24年)3月期
第2四半期(上半期)決算説明会**

2011年11月4日

株式会社フジミインコーポレーテッド

目 次

■ 決算概要	… 2
■ 用途別売上高	… 7
■ 各事業の取り組み	… 13
■ 設備投資額・減価償却費・研究開発費	… 15
■ 損益分析・人員の推移	… 24
■ 経営課題	… 29
■ 補足説明資料・マーケットデータ等	… 32

決算概要

決算概要(上半期実績)

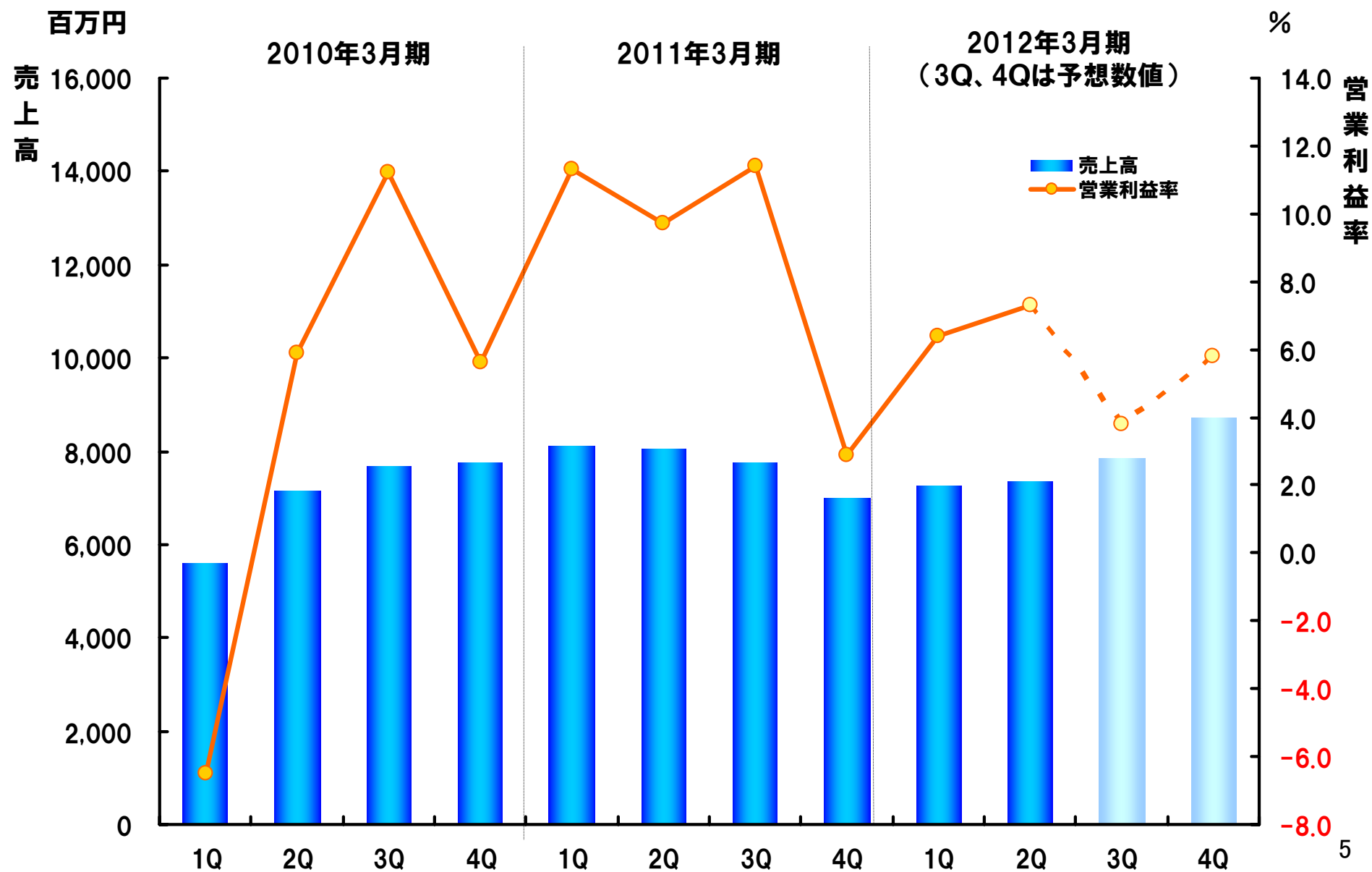
百万円	2011年3月期 上半期 実績	2012年3月期 上半期 予想 8/1	2012年3月期 上半期 修正予想 10/3	2012年3月期 上半期 実績	前年同期比	予想比 8/1	修正予想比 10/3
売上高	16,137	14,600	14,600	14,631	△9.3%	0.2%	0.2%
営業利益	1,691	550	800	1,001	△40.8%	82.1%	25.2%
営業利益率	10.5%	3.8%	5.5%	6.8%	-	-	-
経常利益	1,729	600	850	1,022	△40.9%	70.4%	20.3%
経常利益率	10.7%	4.1%	5.8%	7.0%	-	-	-
当期純利益	1,134	400	550	688	△39.3%	72.1%	25.2%

業績予想(通期)

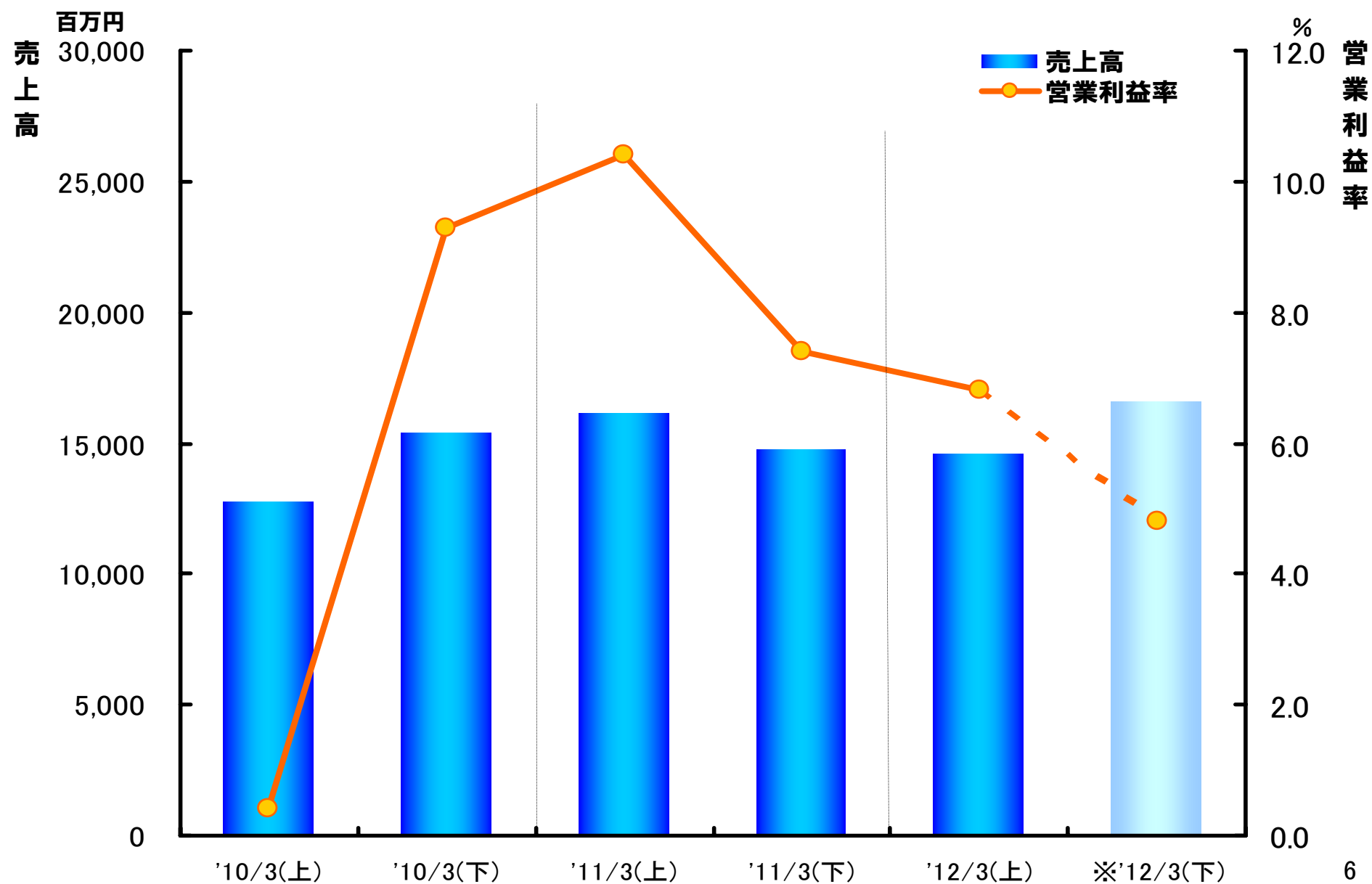
百万円	2011年3月期 実績	2012年3月期 通期予想※ 11/1	前年同期比
売上高	30,869	31,200	1.1%
営業利益	2,777	1,800	△35.2%
営業利益率	9.0%	5.8%	-
経常利益	2,817	1,900	△32.6%
経常利益率	9.1%	6.1%	-
当期純利益	1,820	1,300	△28.6%

※通期予想は、従来予想(8/1開示)を据え置き。

業績推移（四半期）



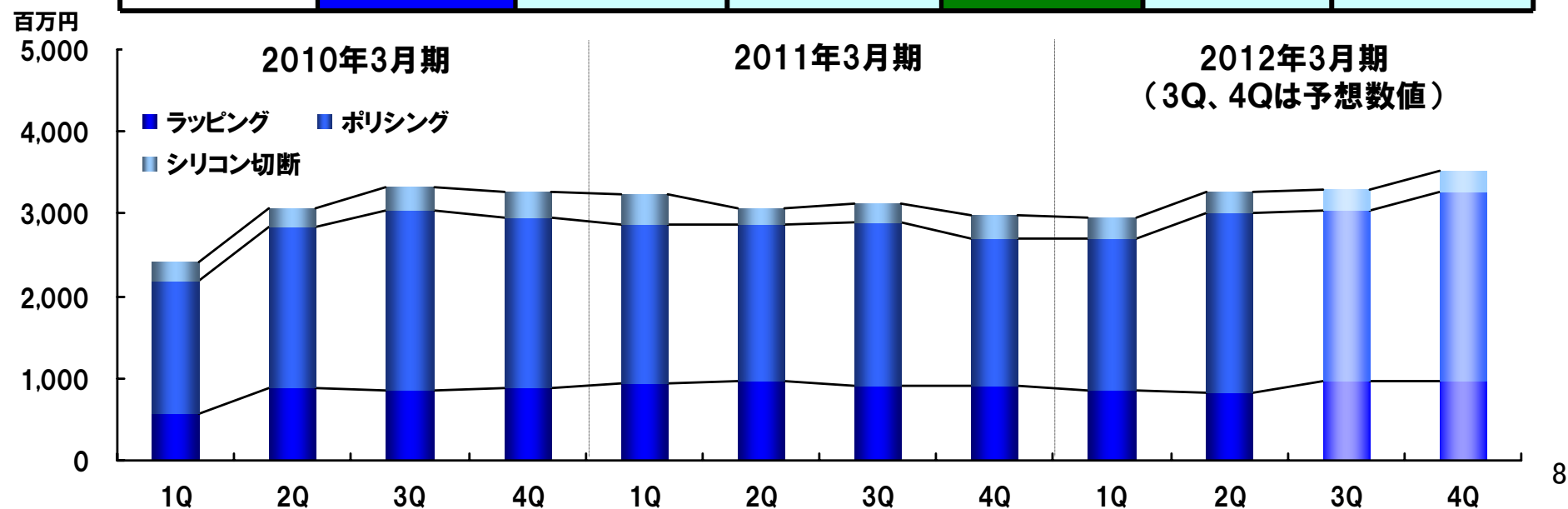
業績推移（半期）



用途別売上高

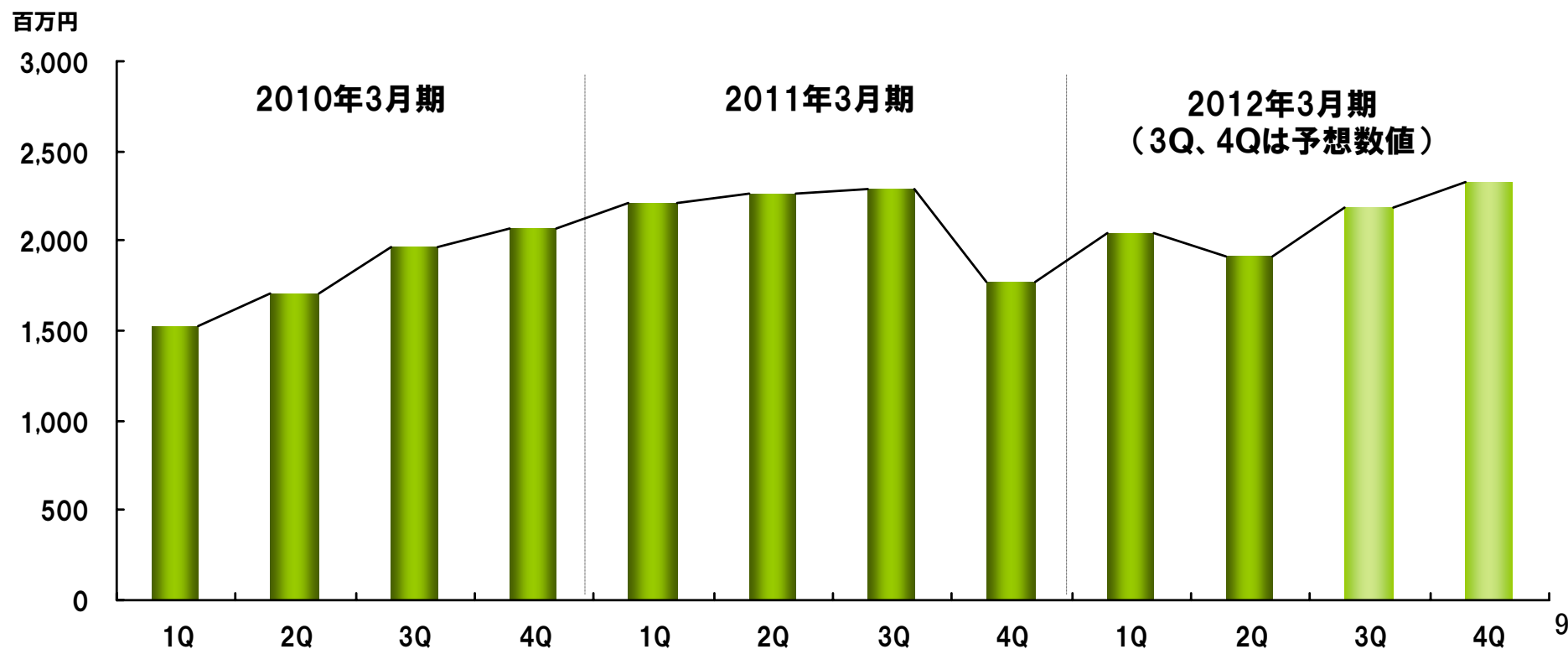
シリコン売上高

	2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)	2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)
ラッピング	1,685	1,912 △11.8%	1,777 △5.1%	3,623	3,718 △2.5%	3,715 △2.5%
ポリシング	3,892	3,910 △0.5%	3,944 2.2%	8,247	7,595 8.6%	8,299 △0.6%
シリコン切断	520	604 △13.9%	493 5.5%	1,043	1,142 △3.2%	1,016 2.7%
計	6,099	6,427 △5.1%	6,214 0.3%	12,915	12,456 3.7%	13,030 △0.9%



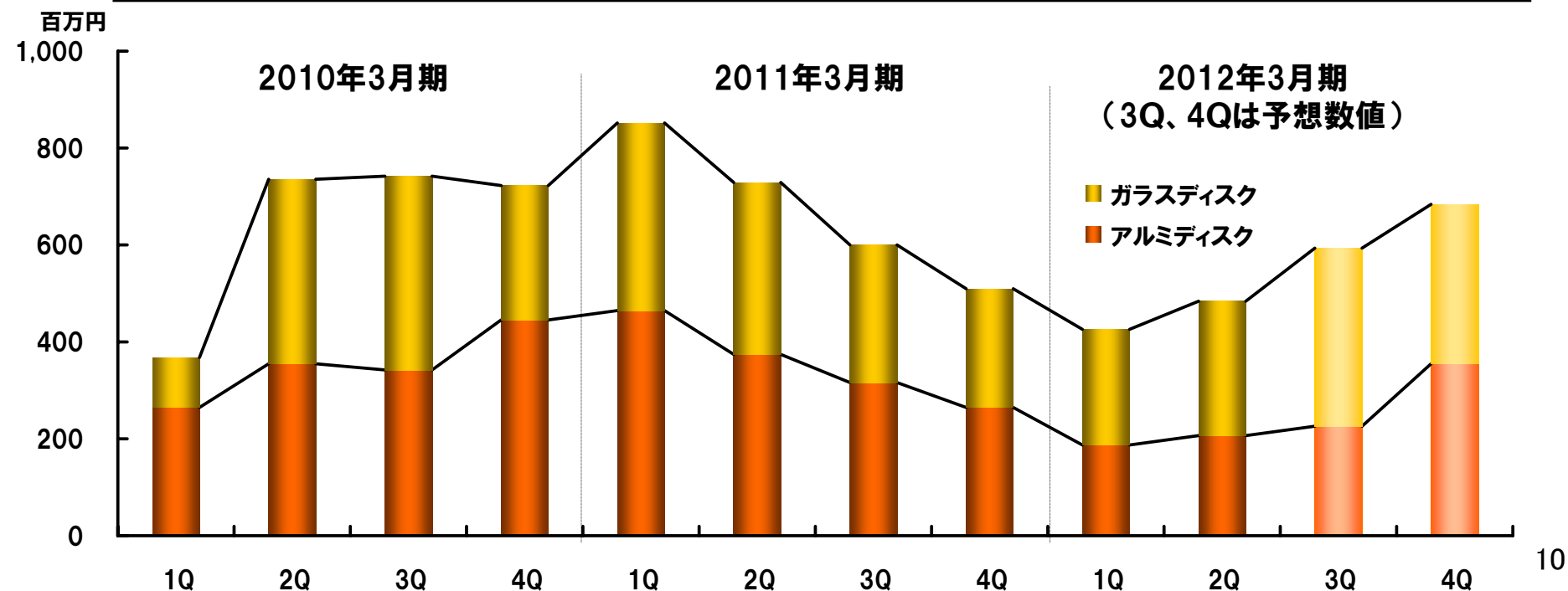
CMP売上高

	2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)	2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)
CMP	3,953	4,471 △11.6%	3,972 △0.5%	8,461	8,532 △0.8%	8,480 △0.2%



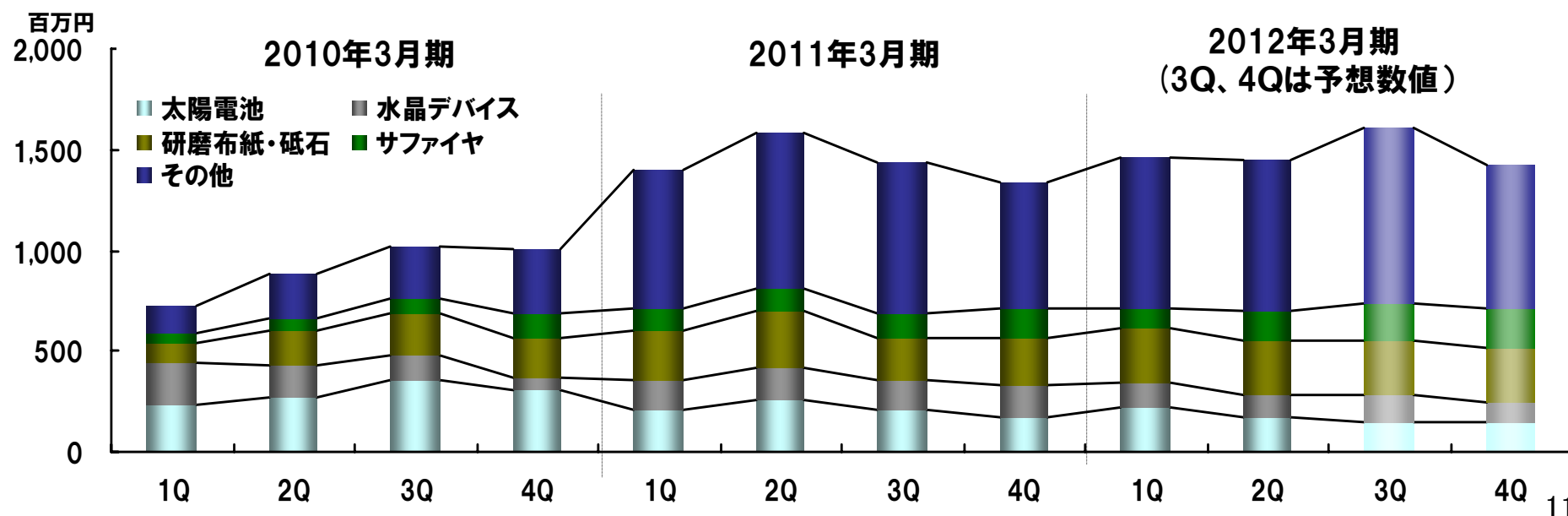
ディスク売上高

	2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)	2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)
アルミディスク	394	835 △52.7%	386 2.3%	969	1,414 △31.4%	961 0.9%
ガラスディスク	517	746 △30.6%	534 △3.0%	1,221	1,275 △4.2%	1,198 2.0%
計	912	1,581 △42.3%	920 △0.8%	2,191	2,689 △18.5%	2,159 1.5%



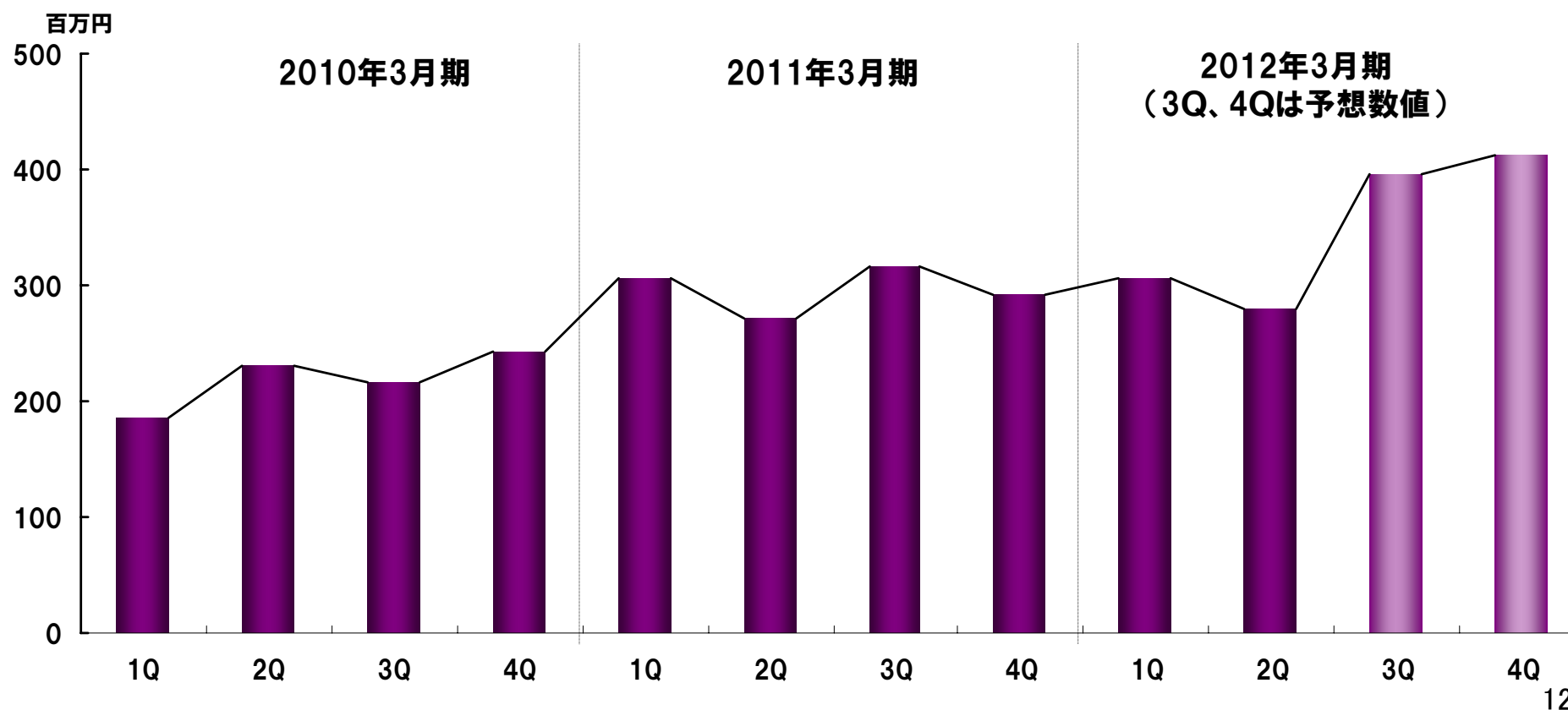
機能材売上高

	2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)	2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)
太陽電池	382	347 10.1%	384 △0.5%	682	704 △3.2%	684 △0.3%
水晶デバイス	243	279 △12.7%	247 △1.6%	474	522 △9.2%	478 △0.7%
研磨布紙・砥石	543	538 0.9%	556 △2.2%	1,081	987 9.6%	1,094 △1.1%
サファイヤ	248	221 12.0%	274 △9.5%	626	493 26.8%	652 △4.0%
その他	1,492	1,458 2.4%	1,295 15.3%	3,074	2,831 8.6%	2,948 △4.3%
計	2,910	2,844 2.3%	2,756 5.6%	5,939	5,539 7.2%	5,856 △1.4%



溶射材売上高

	2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)	2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	8/1予想 (対比)
溶射材	586	580 1.0%	605 △3.1%	1,394	1,188 17.3%	1,413 △1.3%



各事業の取り組み

各事業の取り組み

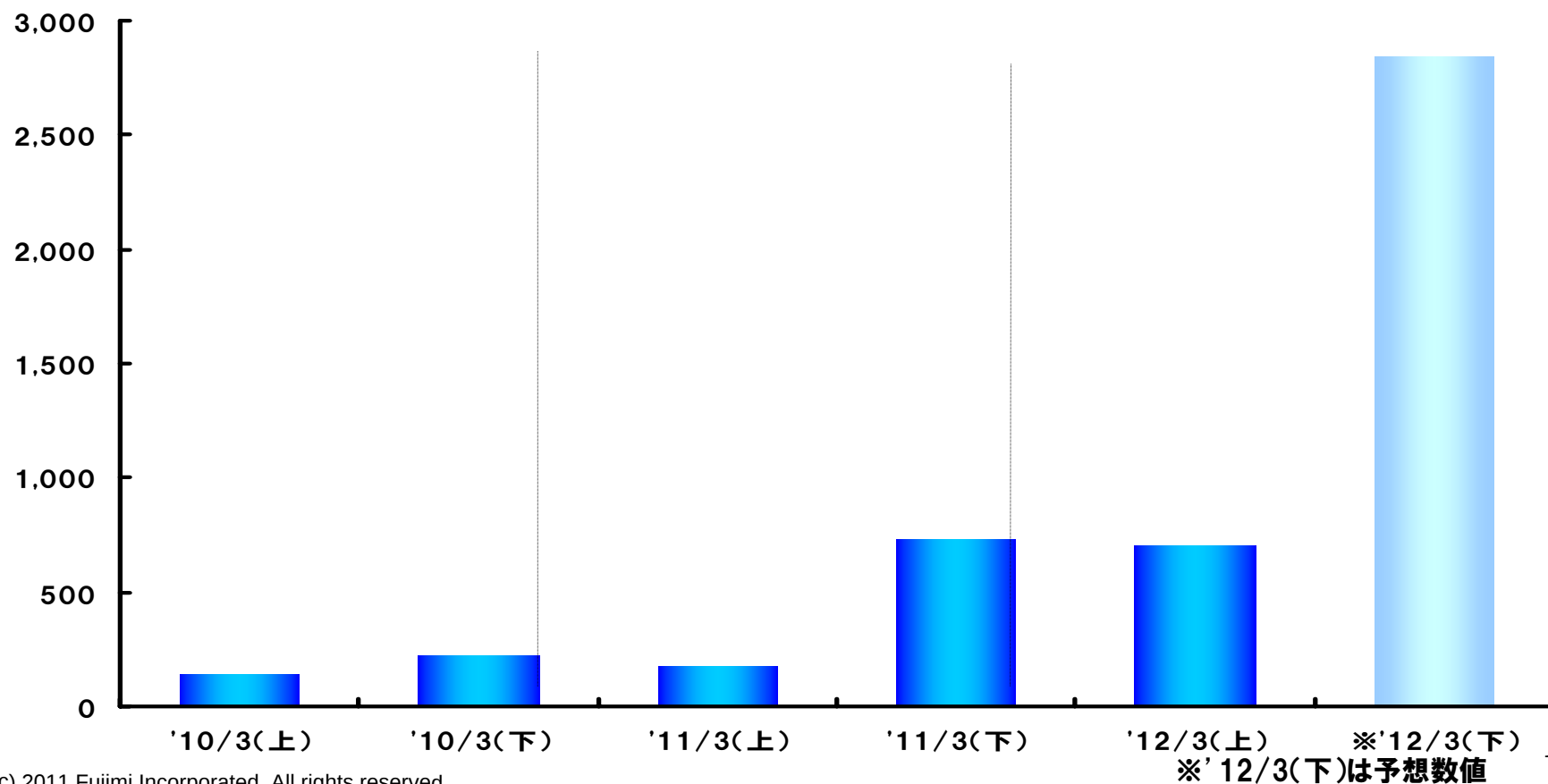
シリコン	上半期: ラッピング材については、東日本大震災による生産停止等の影響があり、またデジタル家電向け、パワー半導体向けの停滞により小径ウェハー生産調整等が進み売上減。ポリッシング材、シリコン切断については震災等の影響なし。 下半期: 震災後の回復を期待するとともに、ポリッシング材については、比較的シェアの低い1、2次研磨用次世代品の採用および売上拡大を図る。
CMP	上半期: PC出荷台数の減少、台湾DRAMおよびファウンドリーの稼働率低下により、前年に比べ減少。 下半期: 生産調整が一巡し、4Qは回復を見込んでいる。
ディスク	上半期: 春先のHDD市場が軟調であったのに加え、アルミディスクについては他社への切替、ガラスディスクはユーザーの生産トラブルによる稼働率低下により、売上減。 下半期: HDD市場の回復およびガラスディスク用セリア代替品の売上を見込んでいるが、タイ洪水による影響が懸念される。
機能材	上半期: LEDサファイヤ基板においては生産調整が進んだものの、前年に比べ増加。新規事業(セリア代替品研磨材、硬脆材用研磨材、LED・GaN・SiC)への対応に注力。 下半期: 新規事業については引き続き注力し、硬脆材加工用の研磨材分野で拡販を図る。
溶射材	上半期: 東日本大震災の影響により、半導体用セラミックス等一部の業界が低迷。また、円高等により価格競争力低下により予想比減ではあったものの、前年並みの売上となった。 下半期: 微細化の進展に伴い半導体・液晶用高純度セラミックスの需要拡大を見込むとともに海外への拡販を目指す。

設備投資額 減価償却費 研究開発費

設備投資額(半期)

2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	5/11予想 (対比)	8/1予想 (対比)
705	175	1,714	957
	303.0%	△58.9%	△26.4%

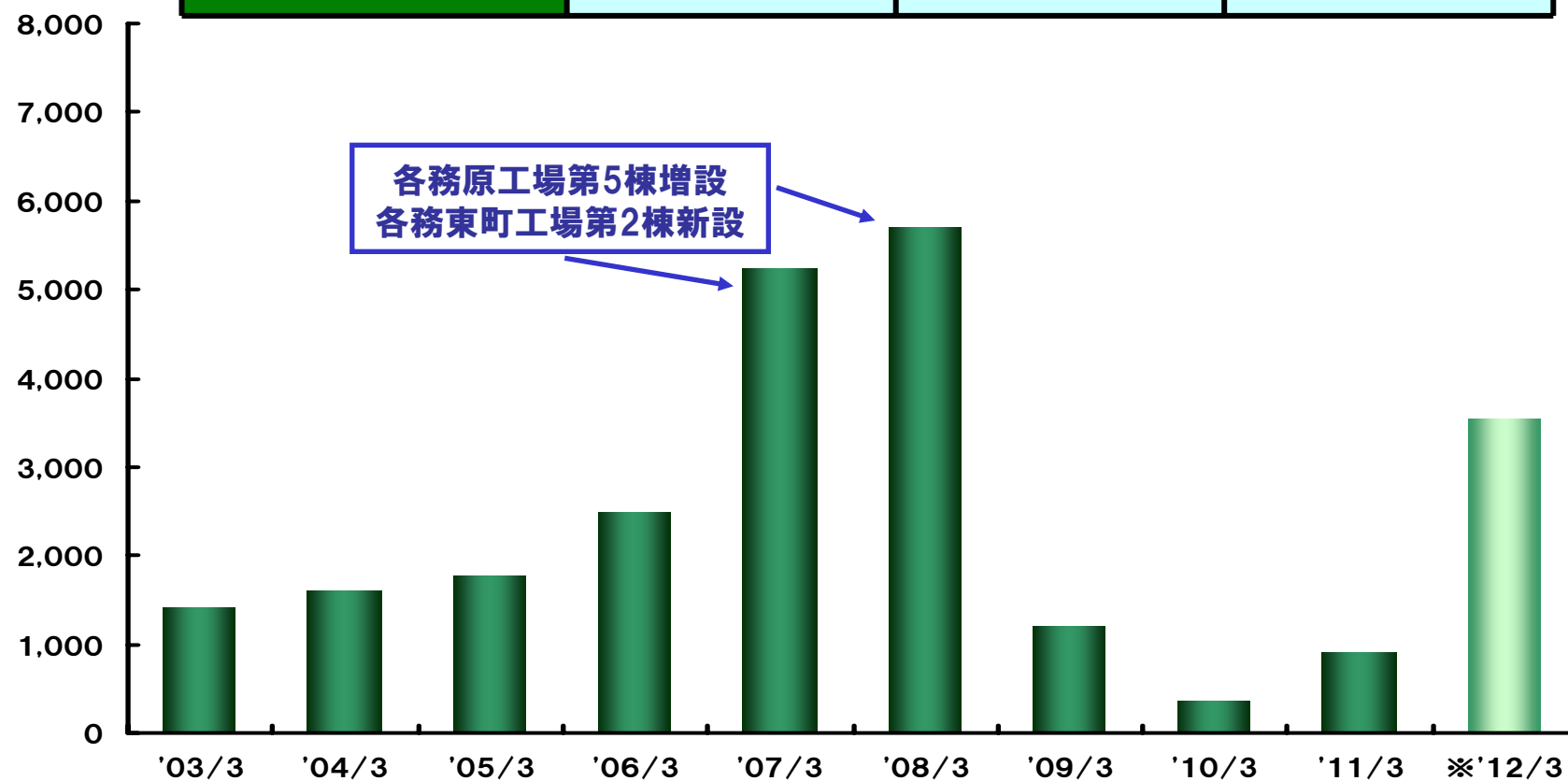
百万円



設備投資額(通期)

2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	5/11予想 (対比)	8/1予想 (対比)
3,549	905	2,356	3,757
	292.0%	50.6%	△5.5%

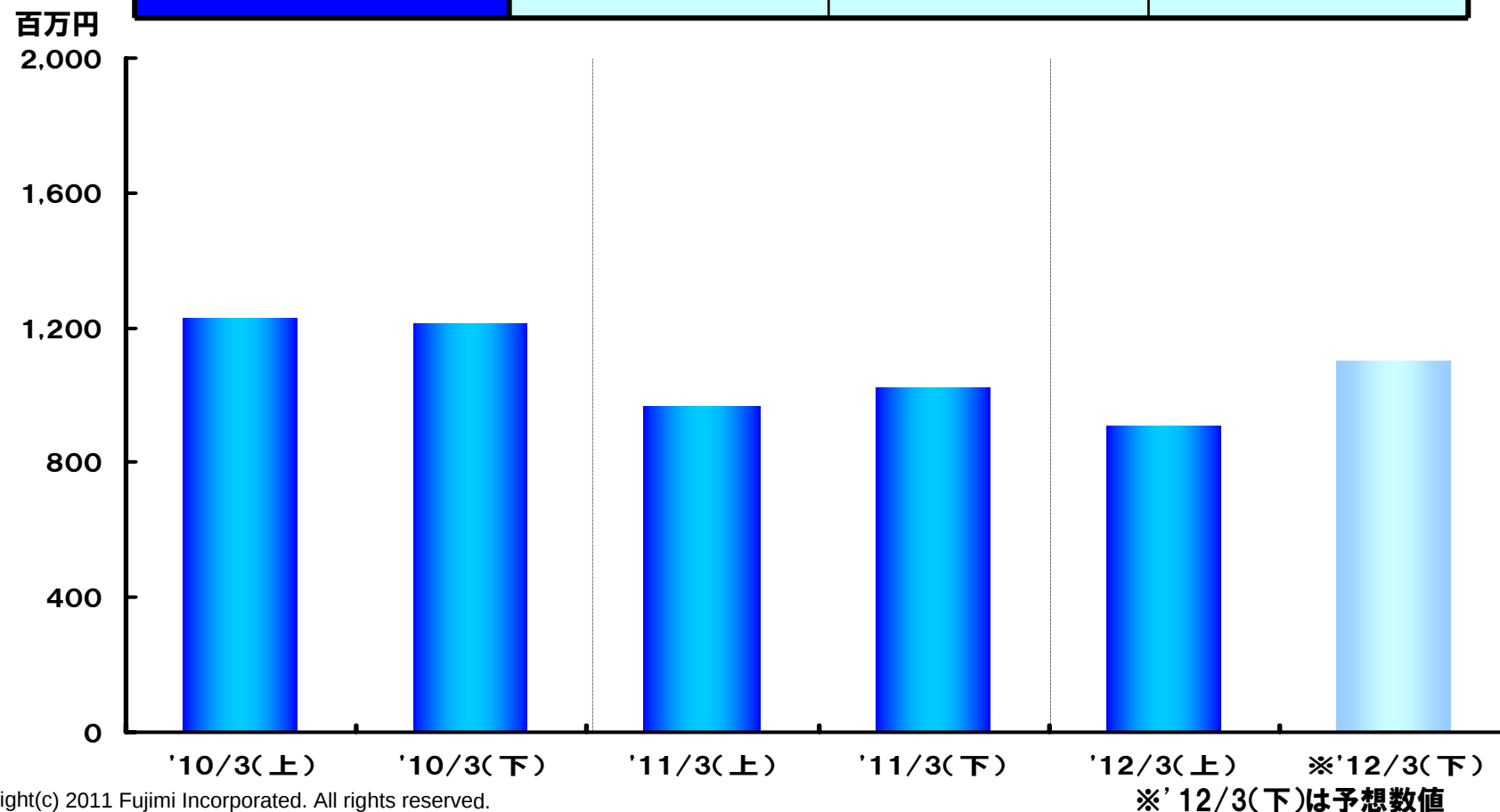
百万円



※'12/3は予想数値

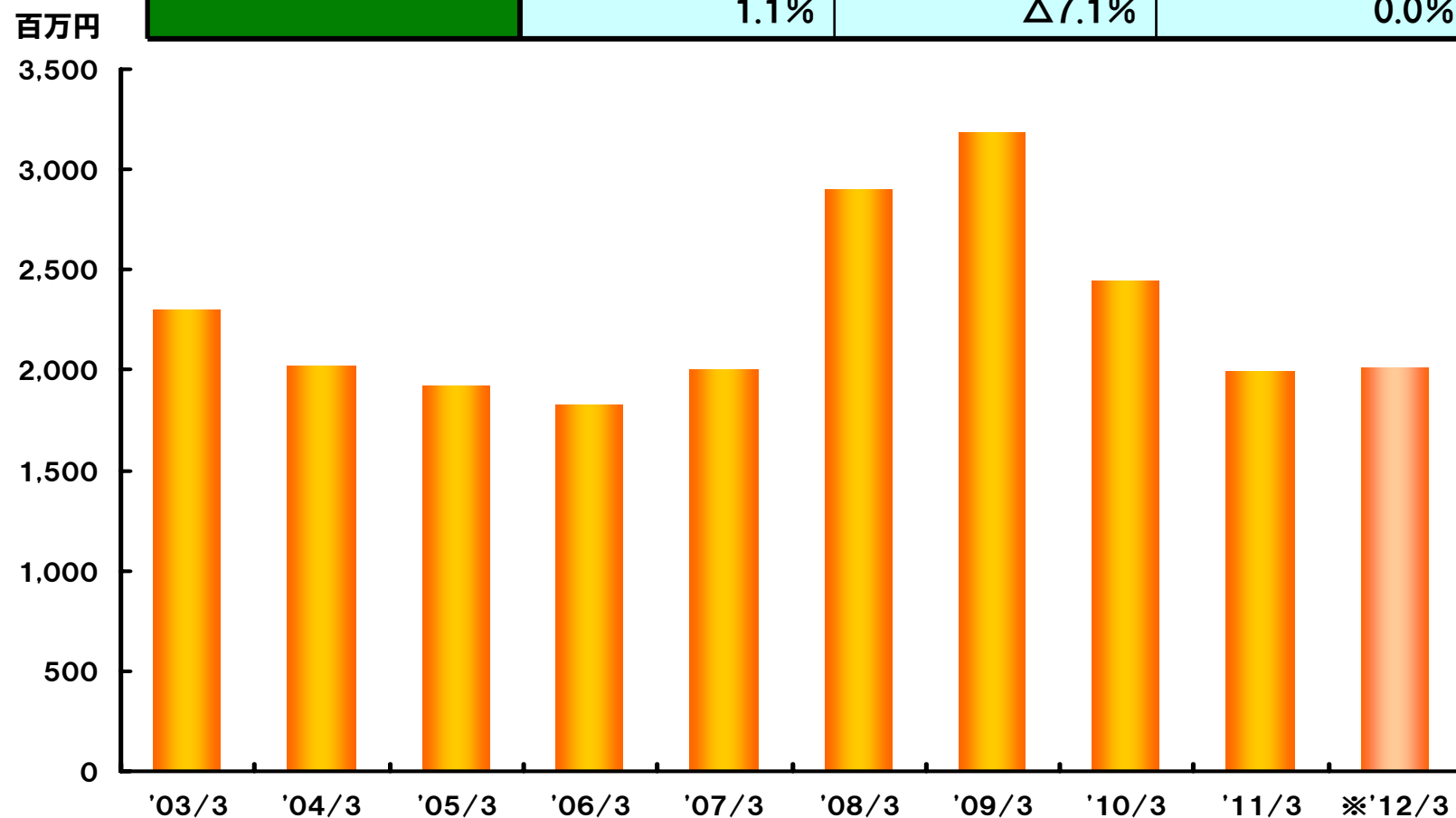
減価償却費(半期)

2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	5/11予想 (対比)	8/1予想 (対比)
910	968	1,006	907
	△6.0%	△9.6%	0.3%



減価償却費(通期)

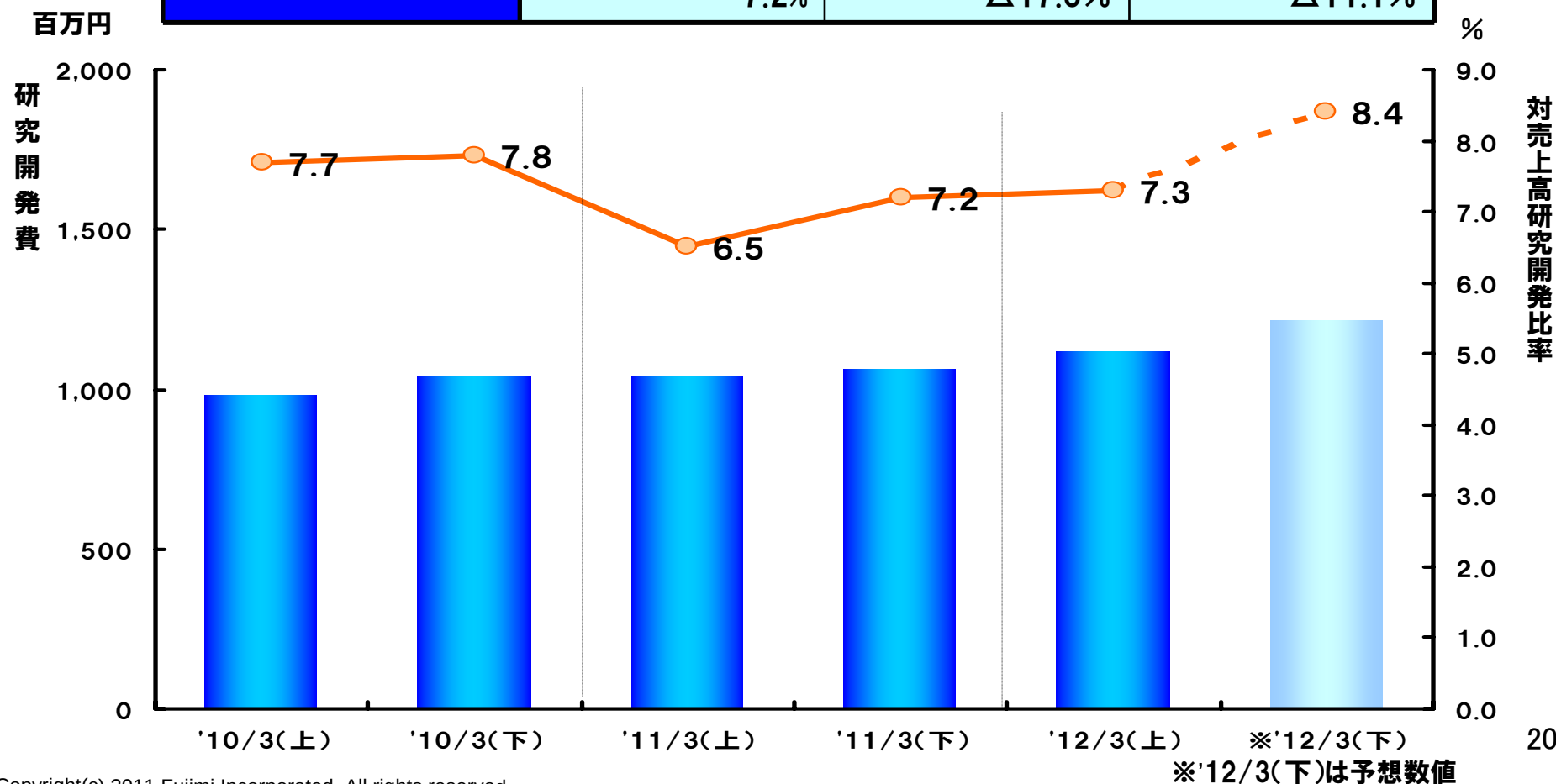
2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	5/11予想 (対比)	8/1予想 (対比)
2,013	1,991	2,167	2,013
	1.1%	△7.1%	0.0%



※'12/3は予想数値

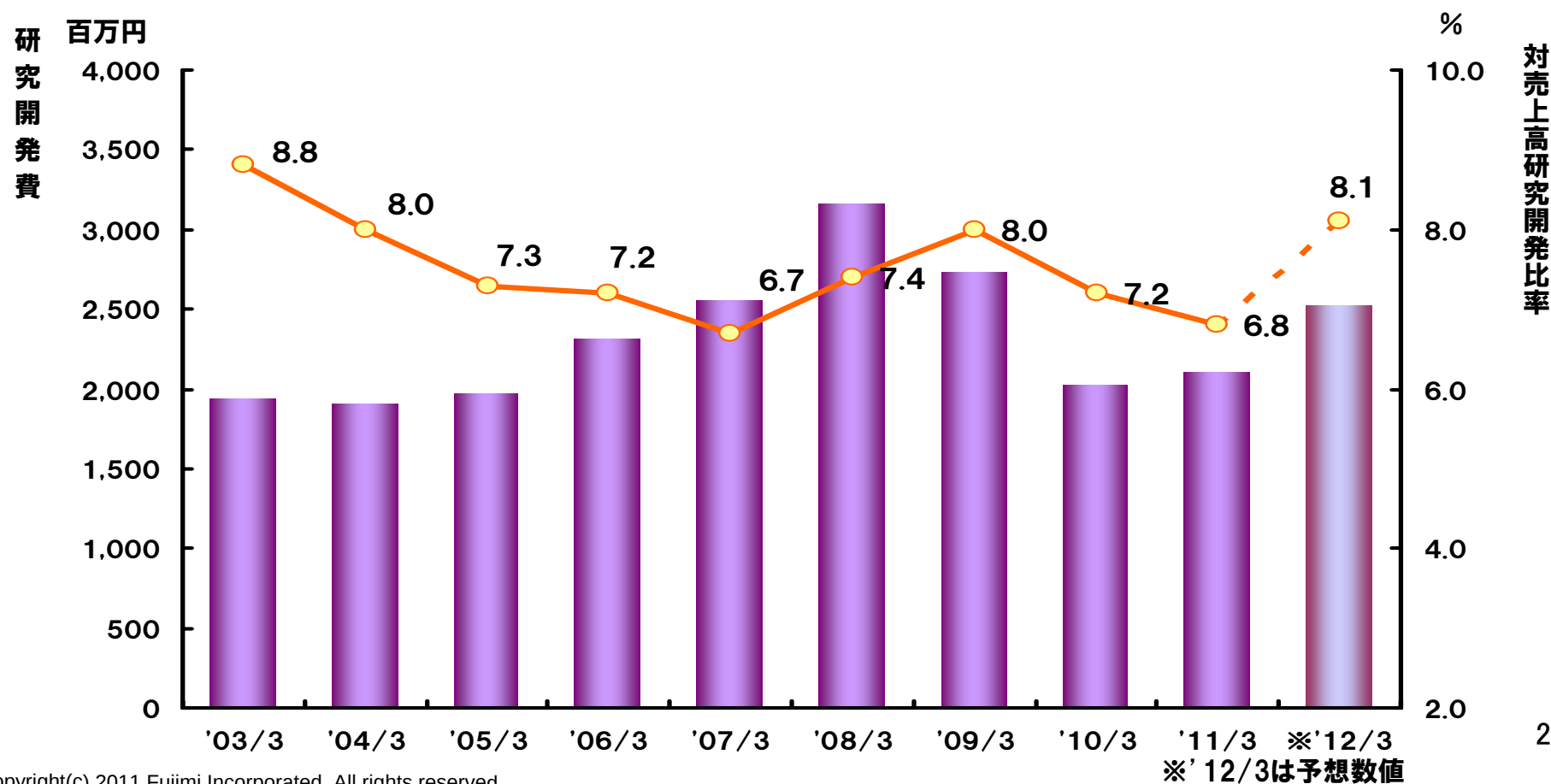
研究開発費／対売上高研究開発比率(半期)

2012年3月期 上期実績	前年実績 (対比)	5/11予想 (対比)	8/1予想 (対比)
1,118	1,043	1,352	1,258
	7.2%	△17.3%	△11.1%

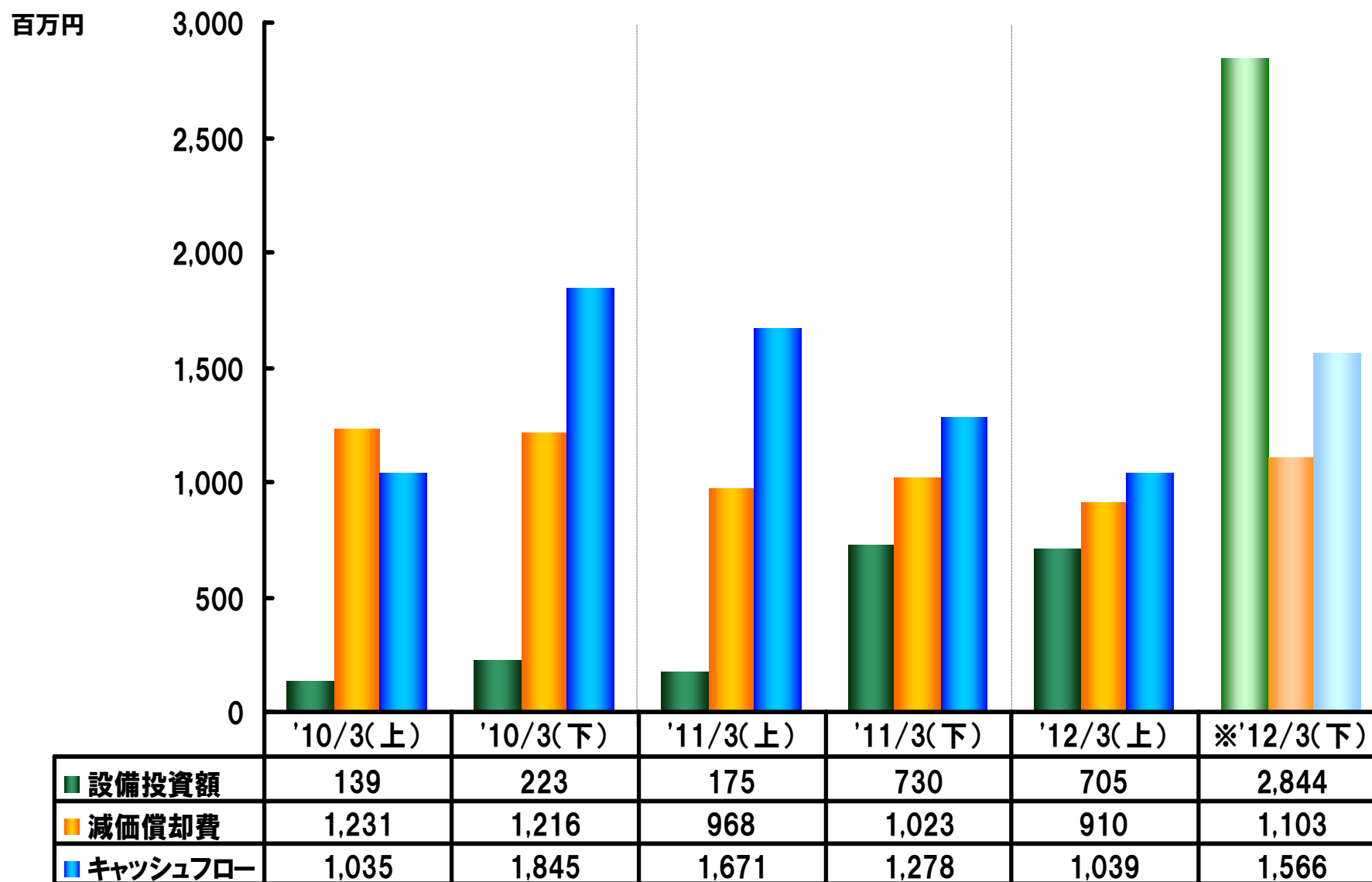


研究開発費(通期)

2012年3月期 通期予想	前年実績 (対比)	5/11予想 (対比)	8/1予想 (対比)
2,524	2,109	2,759	2,716
	19.7%	Δ8.5%	Δ7.1%



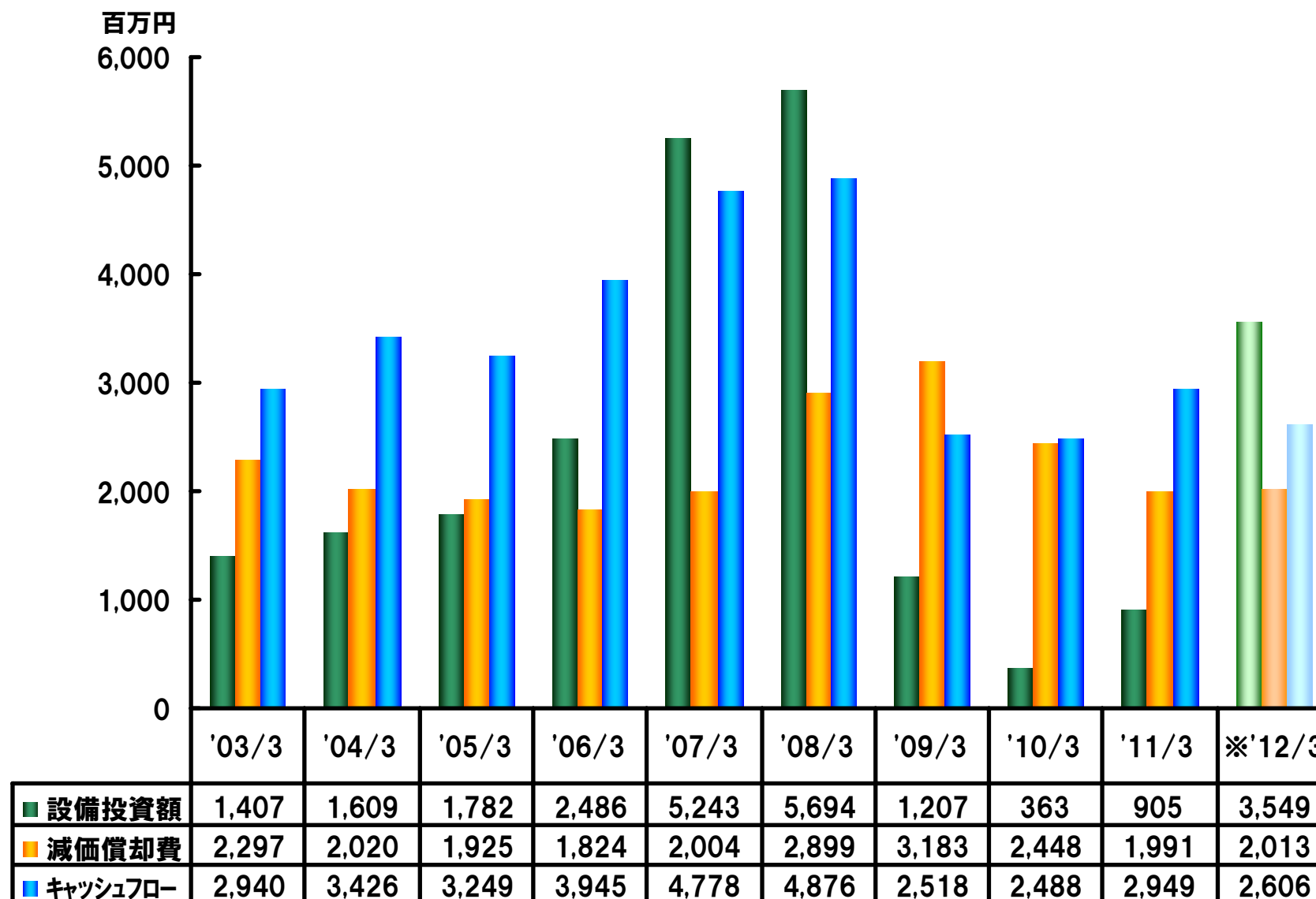
設備投資額／減価償却費／キャッシュフロー（半期）



※キャッシュフロー＝当期純利益＋減価償却費－配当金

※'12/3(下)は予想数値

設備投資額／減価償却費／キャッシュフロー（通期）

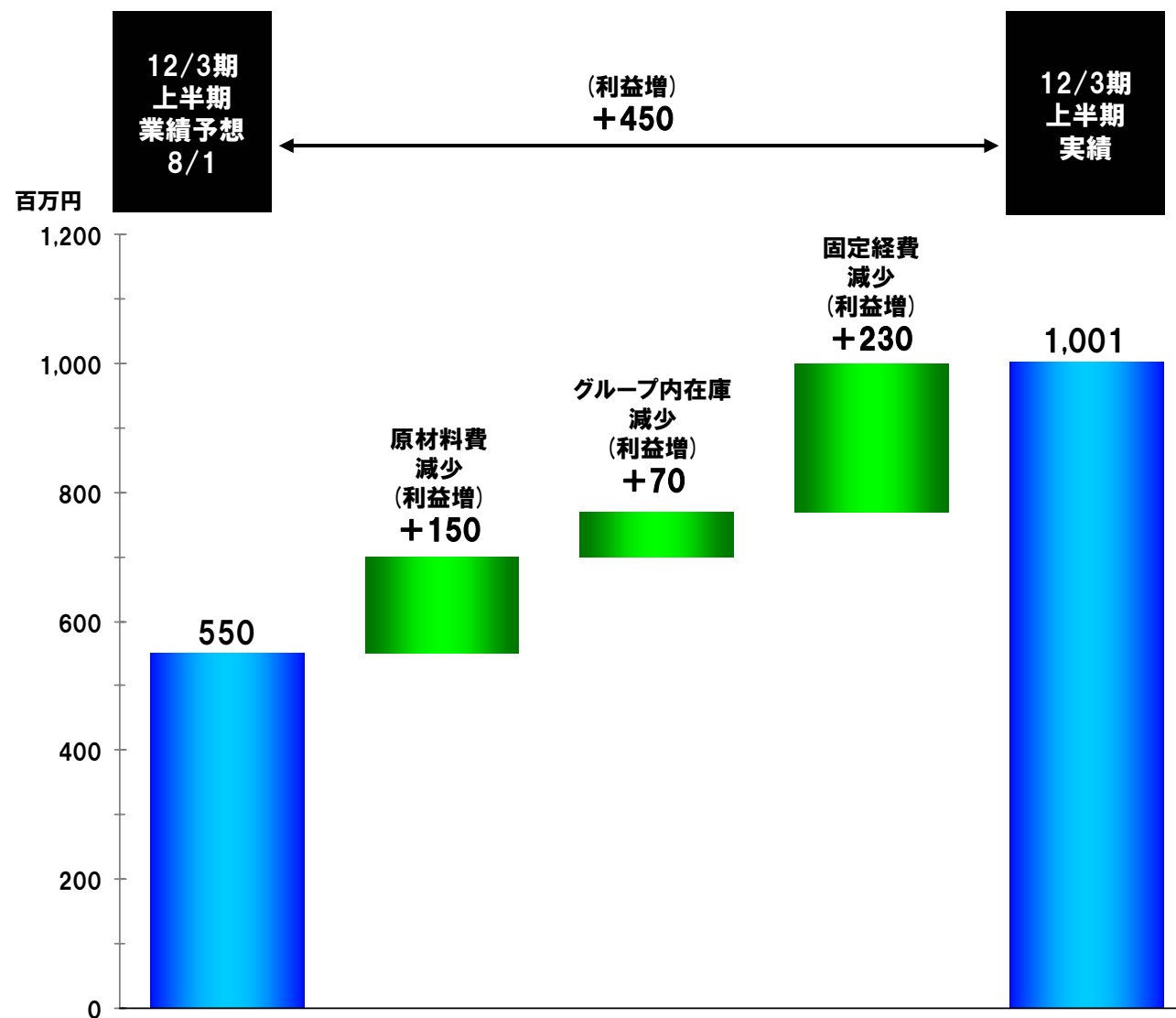


※キャッシュフロー＝当期純利益＋減価償却費－配当金

※'12/3は予想数値

損益分析・人員の推移

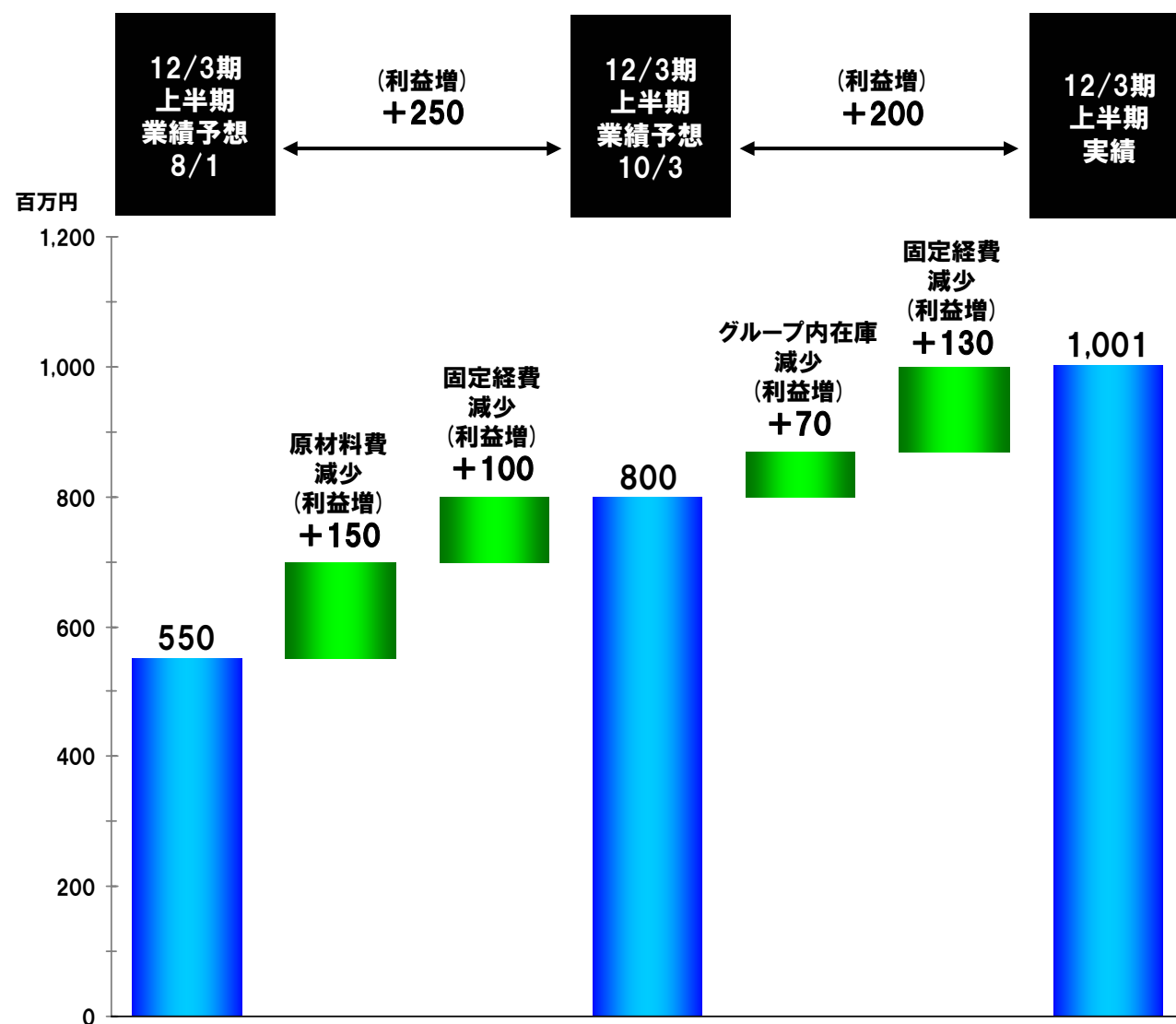
営業利益増減要因



固定経費減少による主な利益増加要因
《上期業績予想(8/1) ⇄ 上期実績》

(利益増)	
修繕費の減少	+70
旅費交通費の減少	+20
消耗品費の減少	+30
支払手数料の減少	+30
その他諸経費の減少	+80

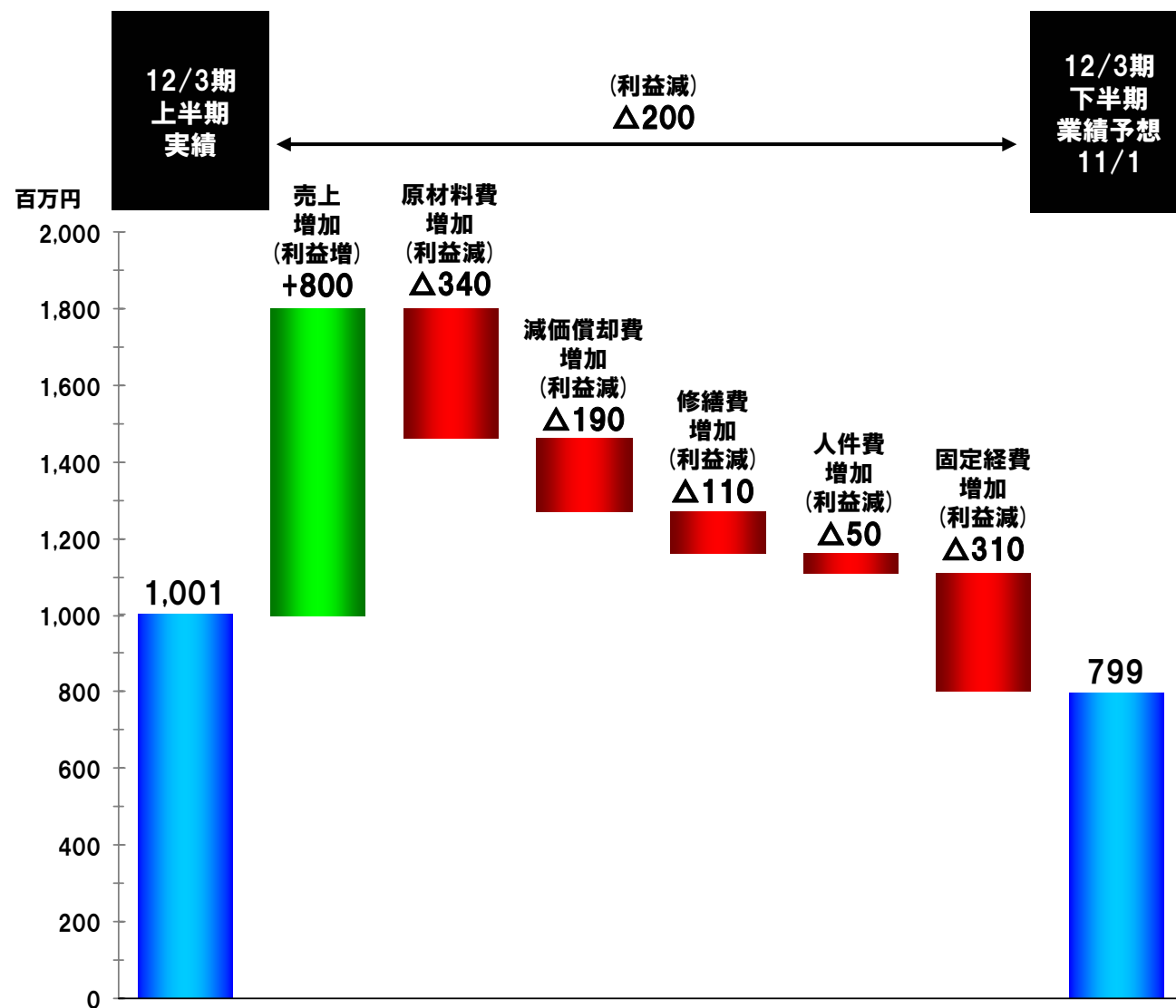
営業利益増減要因



固定経費減少による主な利益増加要因
《上期業績予想(8/1) ⇄ 上期実績》

(利益増)	
修繕費の減少	+70
旅費交通費の減少	+20
消耗品費の減少	+30
支払手数料の減少	+30
その他諸経費の減少	+80

営業利益増減要因



固定経費増加による主な利益減少要因
《上期実績 ⇄ 下期業績予想 (11/1)》

(利益減)	
旅費交通費の増加	$\Delta 30$
消耗品費の増加	$\Delta 30$
支払手数料の増加	$\Delta 80$
その他諸経費の増加	$\Delta 170$

人員の推移

	2011年3月期 上半期		2012年3月期 上半期			
	正社員 (人)	臨時 雇用者 ※1	正社員 (人)	臨時 雇用者 ※1	前年同期比	
					正社員	臨時雇用者
フジミインコーポレーテッド	583	94	597	106	2.4%	12.8%
フジミコーポレーション	95	10	106	3	11.6%	△70.0%
フジミマイクロテクノロジー	63	1	63	1	0.0%	0.0%
フジミヨーロッパ	6	1	7	1	16.7%	0.0%
合 計	747	106	773	111	3.5%	4.7%

※1 臨時雇用者(嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員)は年間の平均人員

経営課題

■グローバル展開

台湾市場におけるCMP製品の積極的拡販と技術支援、新規需要やお客様への対応力強化等を図るため、開発・製造拠点として台湾子会社を8月10日設立

■新規事業創出プロジェクト（“Nプロ”）の継続

当社固有のコア技術（ろ過・分級・精製、パウダー技術、ケミカル技術）を強化・活用し、半導体関連事業に続く新たな基盤事業を創成

■BCP（原材料途絶リスクの低減・生産バックアップ）

原材料調達の複数購買化推進により、製品の安定供給体制の確立を目指す
海外製造拠点でのバックアップ体制の強化

■円高対応

海外生産比率および原材料海外調達比率の引き上げ検討

■原材料価格の上昇

一部原材料価格の上昇に対し、製品価格の値上げや歩留まり改善等の対策の実施

■業務プロセスの改革と社内ナレッジシェアの強化

ＩＴインフラの整備拡充と併せて実施

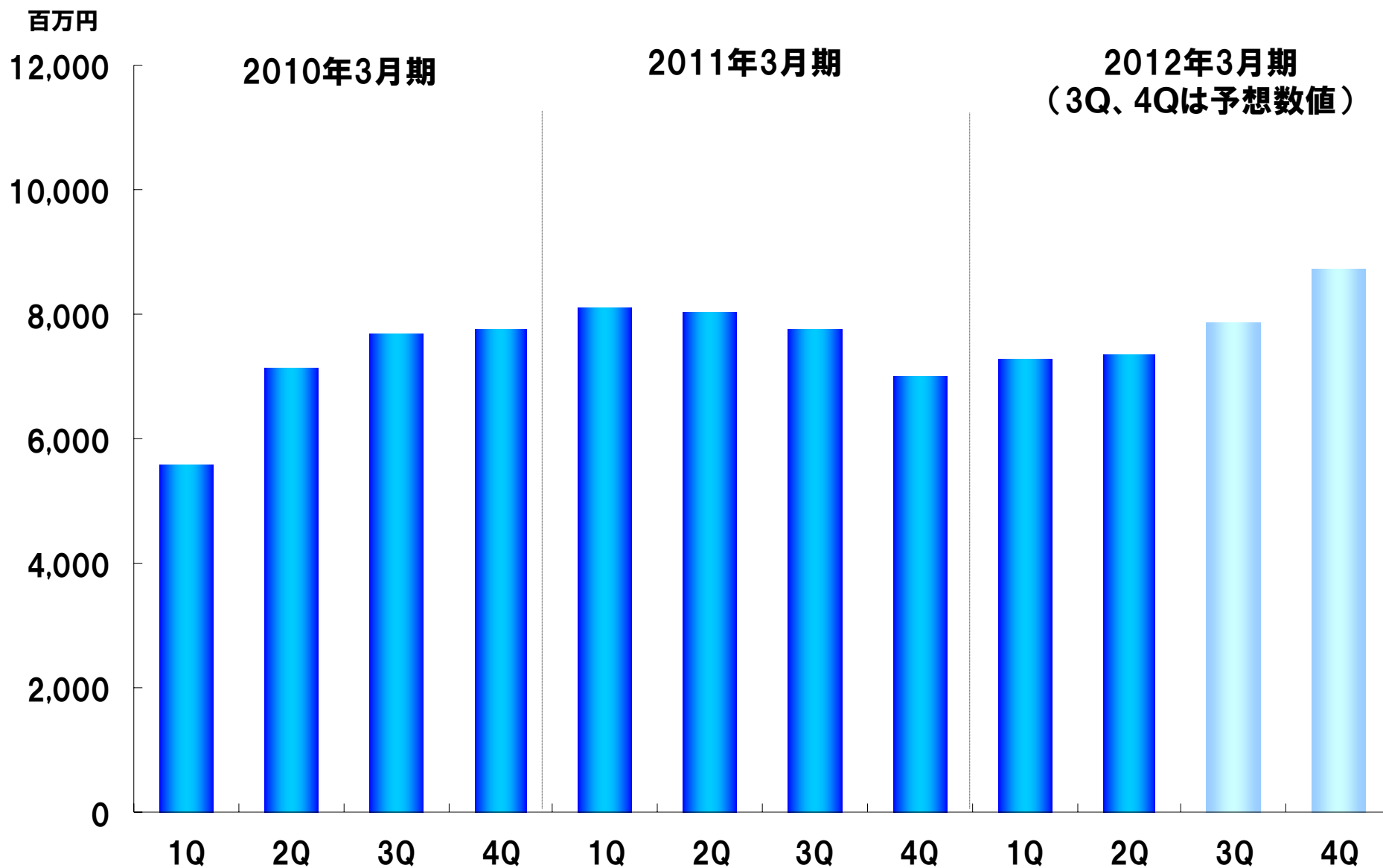
Q & A

ご清聴ありがとうございました

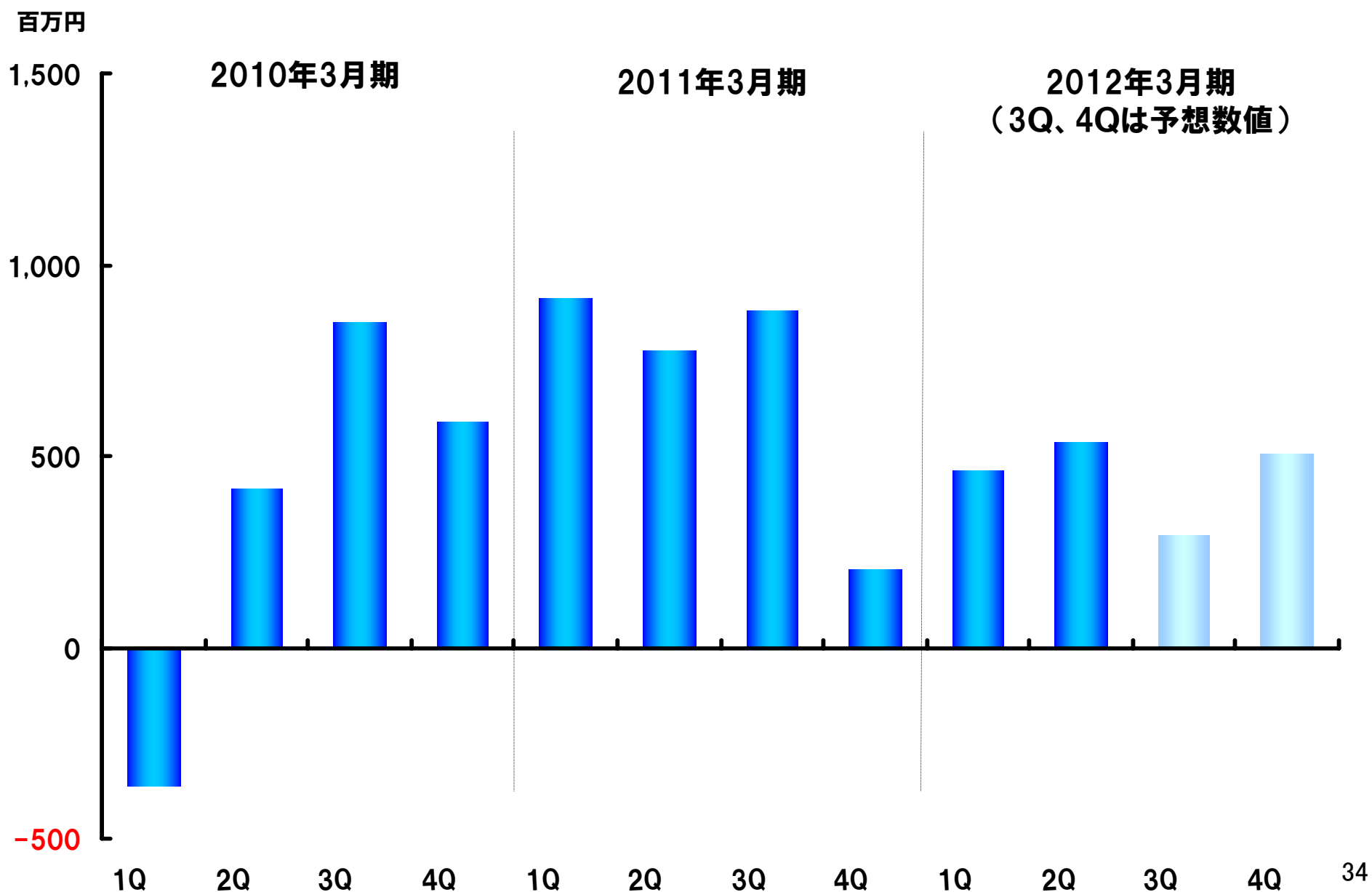
株式会社フジミインコーポレーテッド

補足説明資料 マーケットデータ等

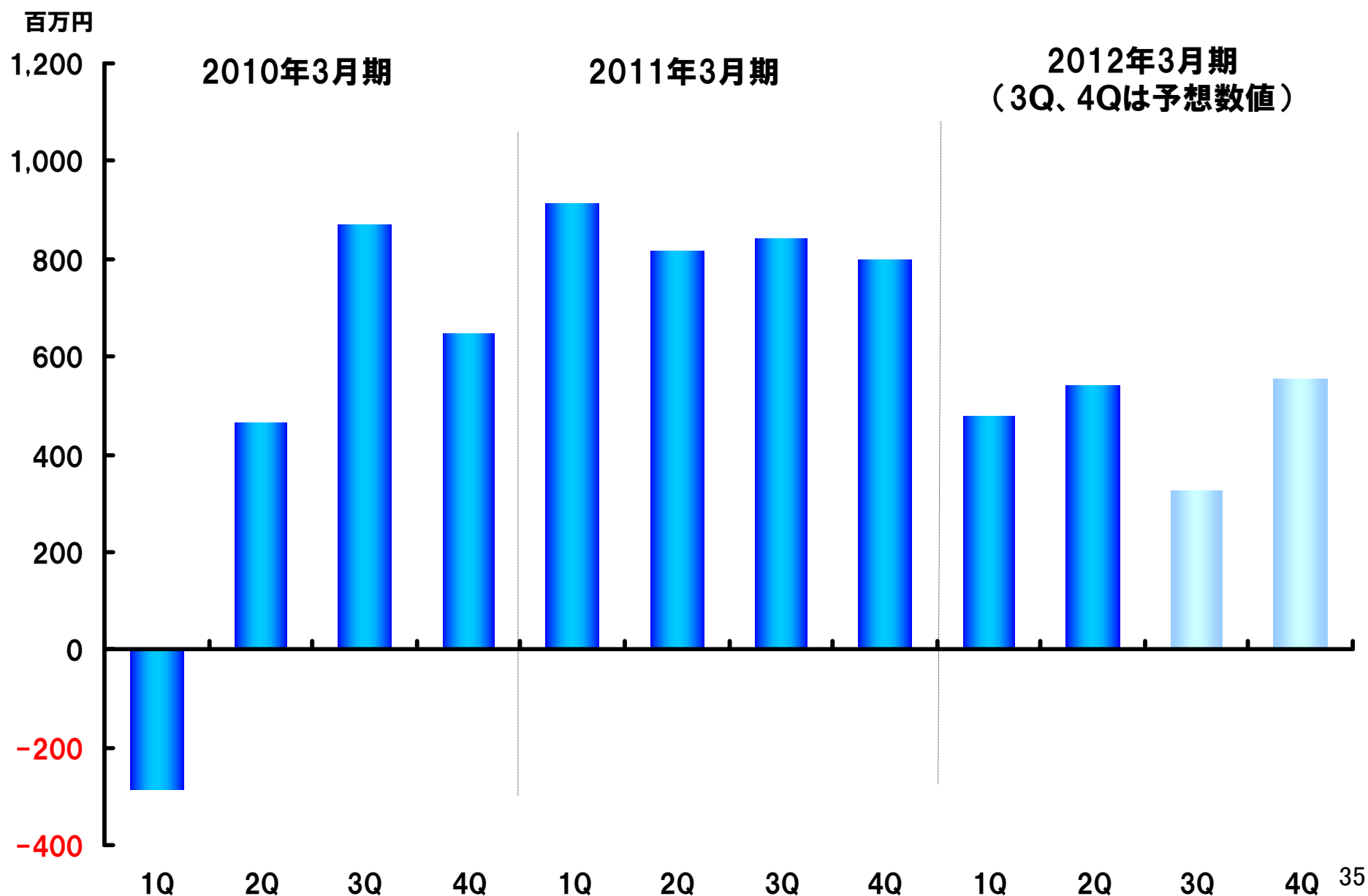
売上高(四半期)



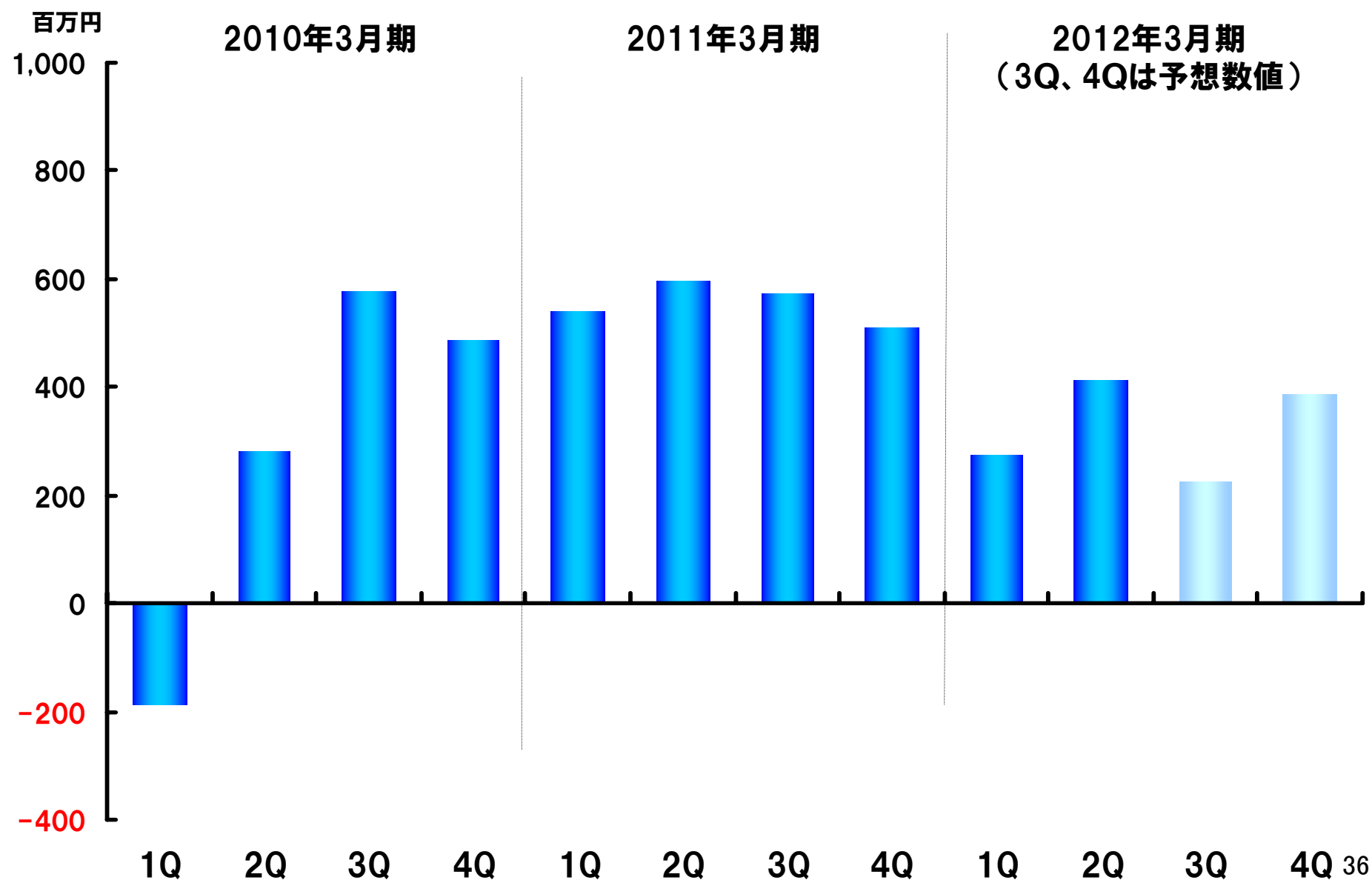
営業利益(四半期)



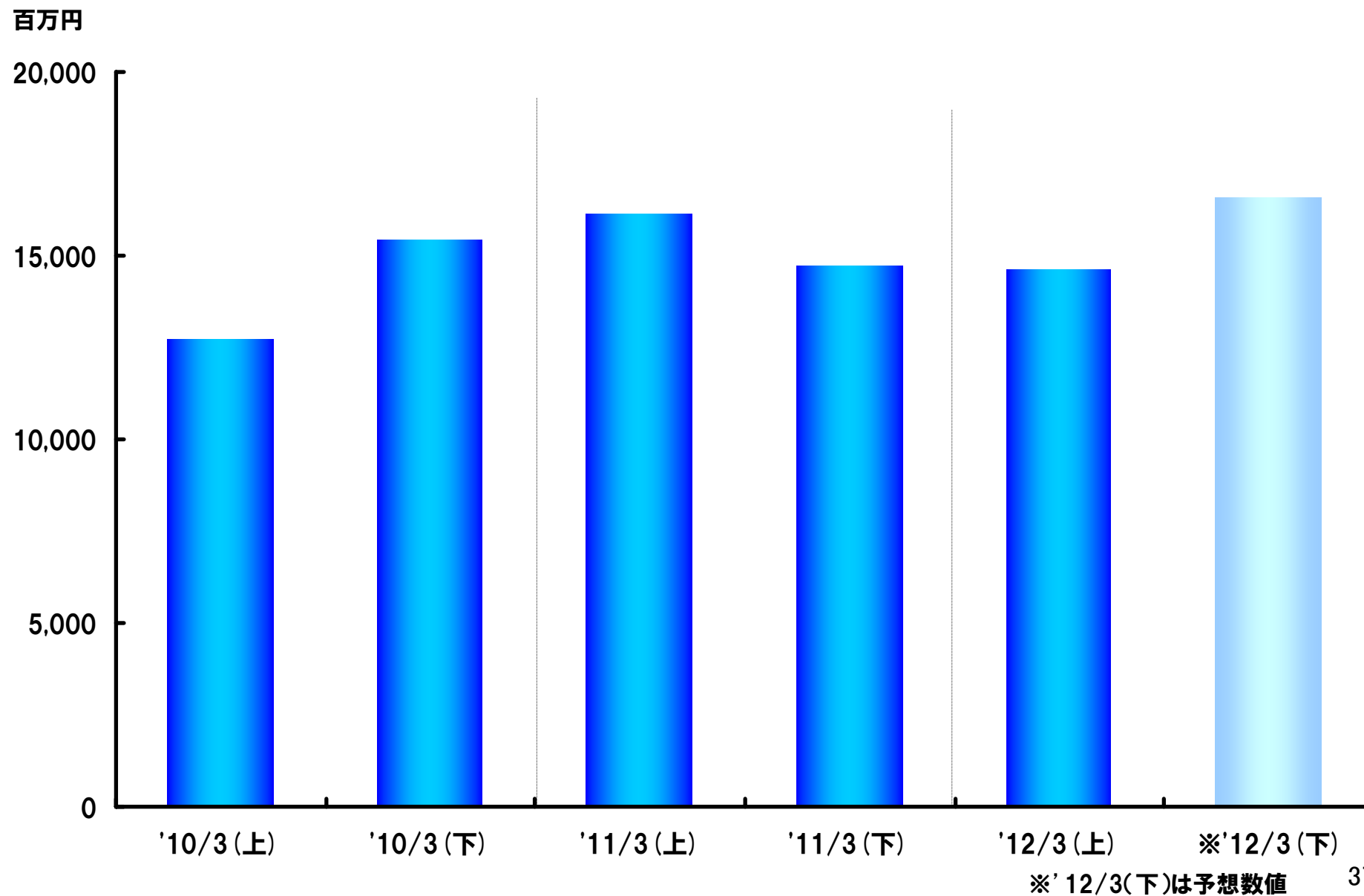
経常利益(四半期)



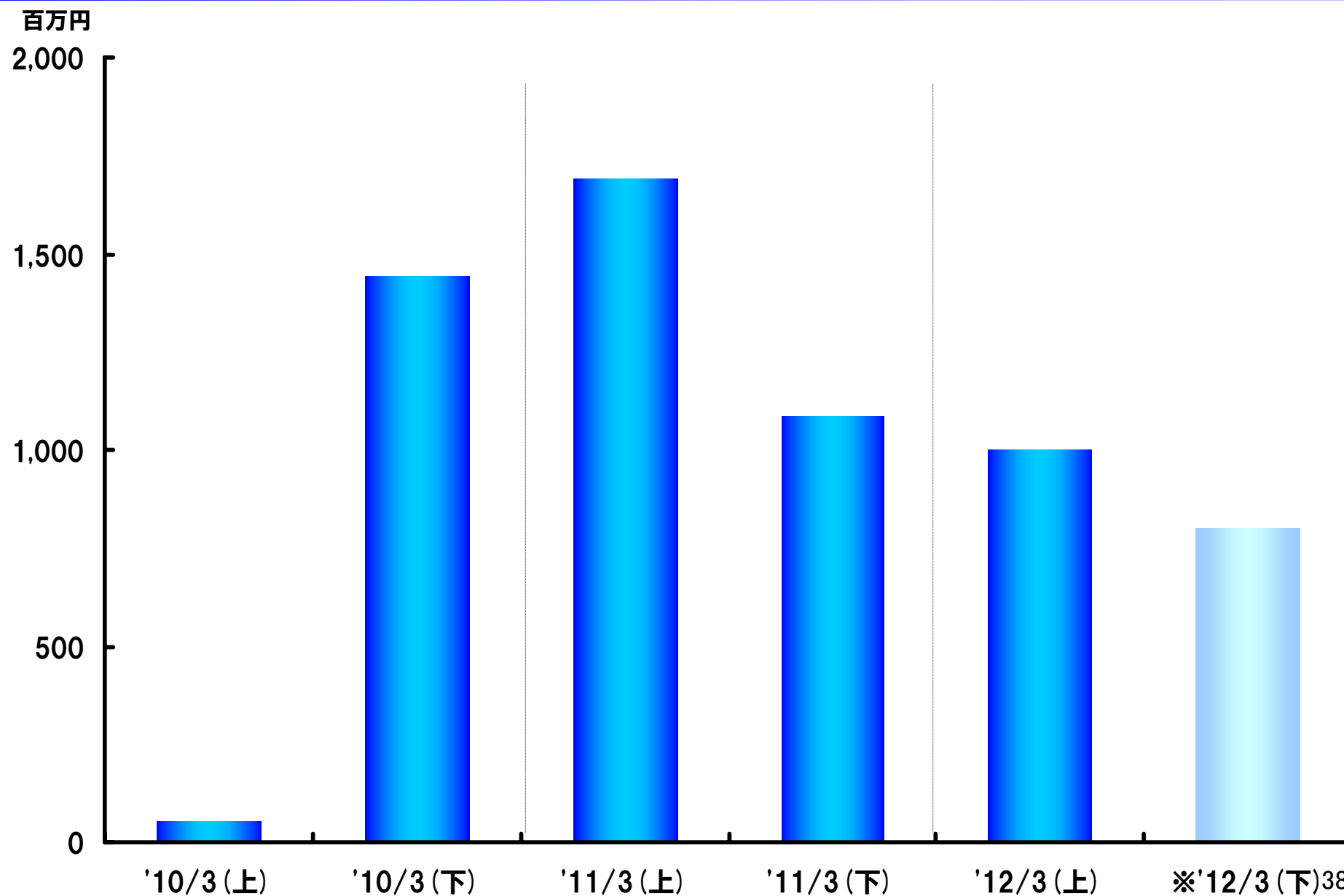
当期純利益(四半期)



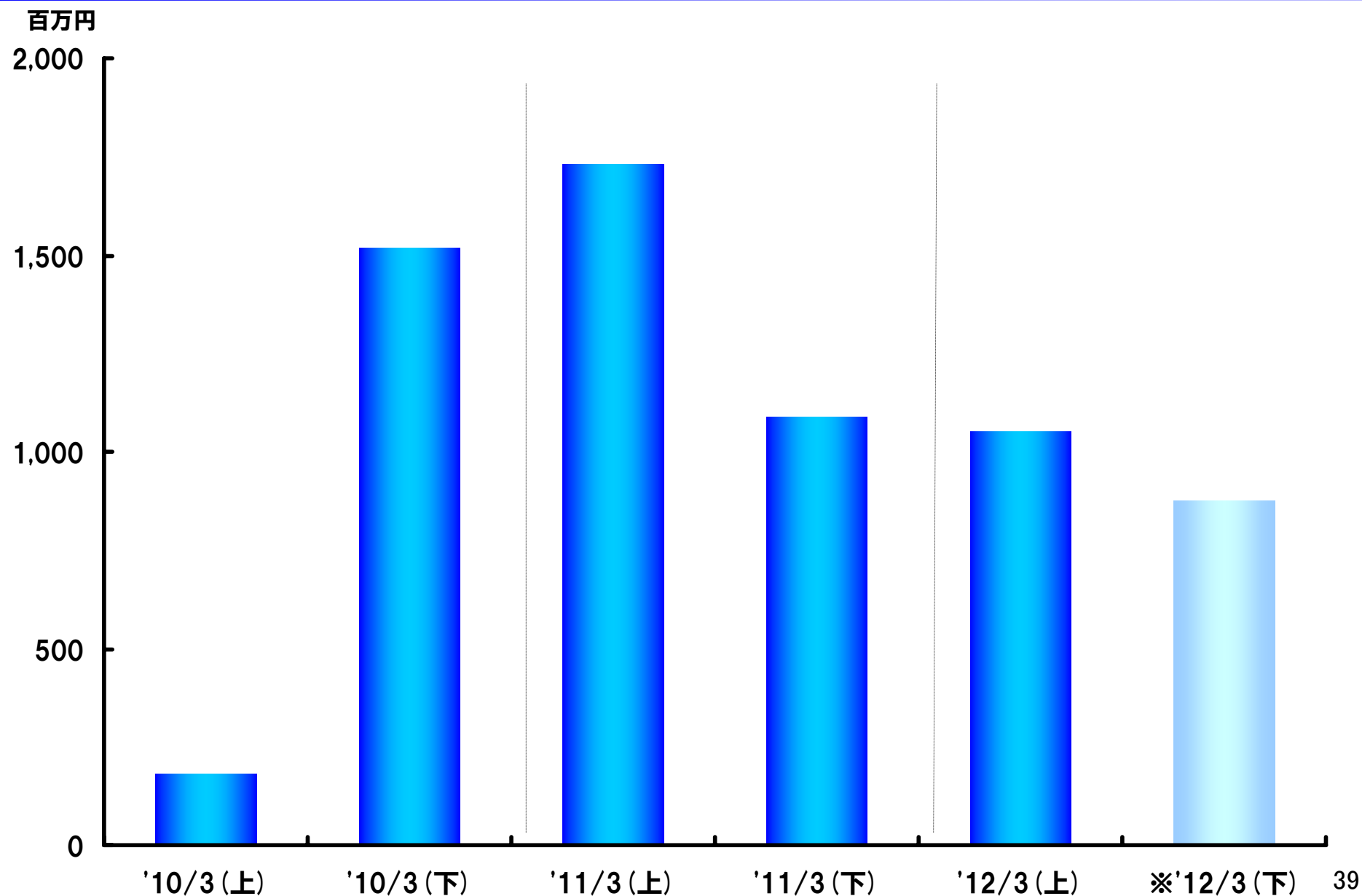
売上高(半期)



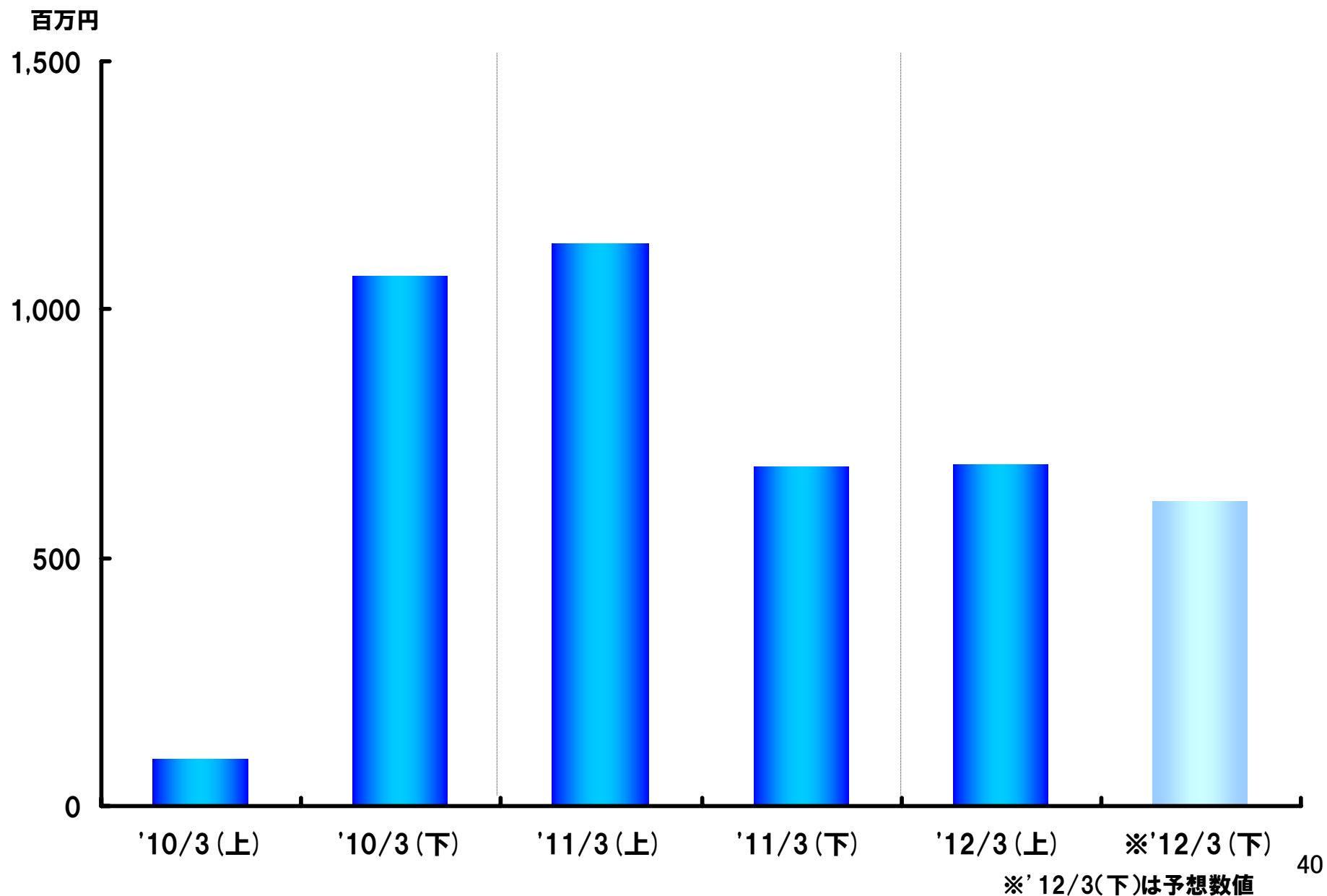
営業利益(半期)



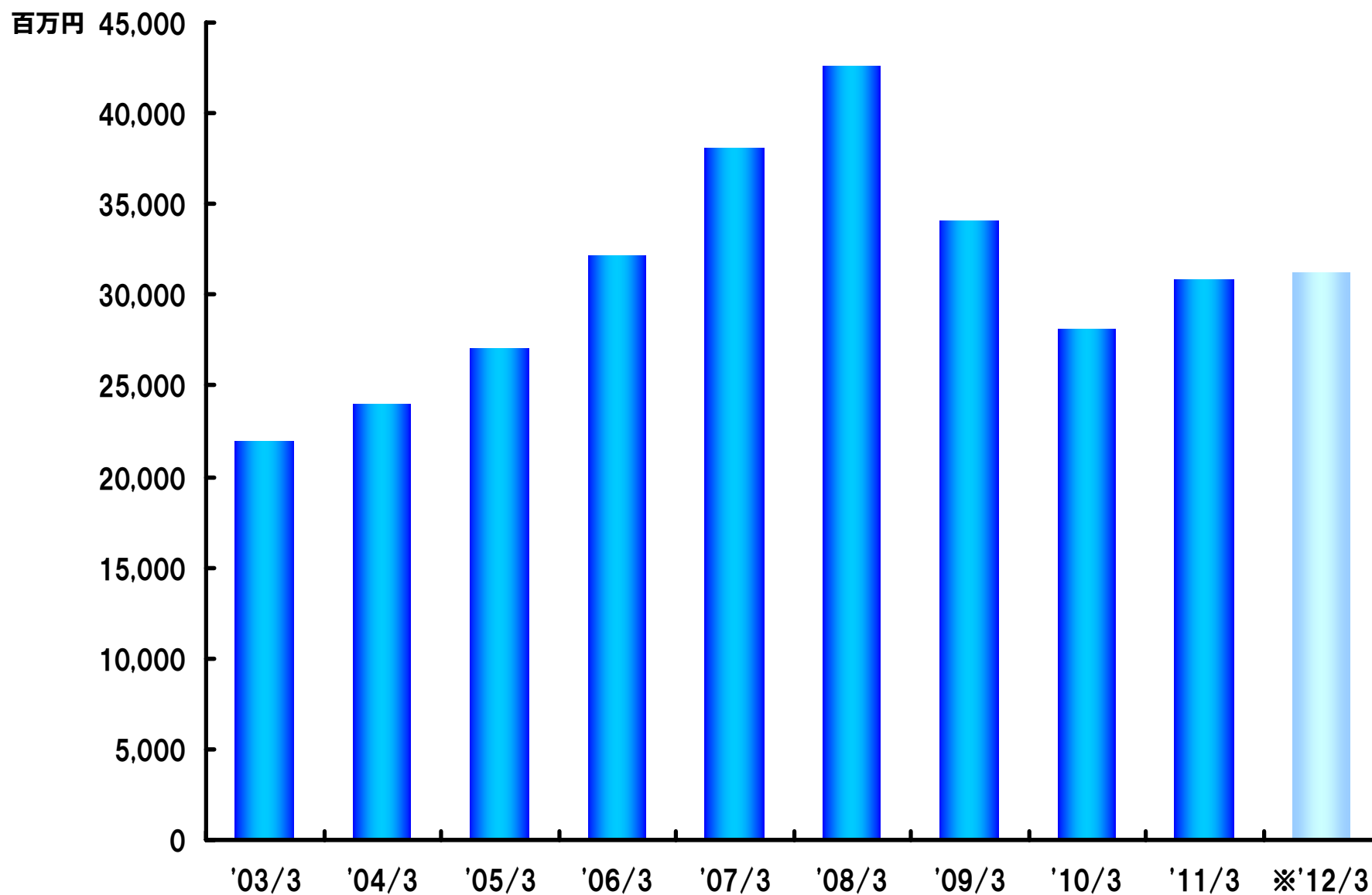
経常利益(半期)



当期純利益（半期）

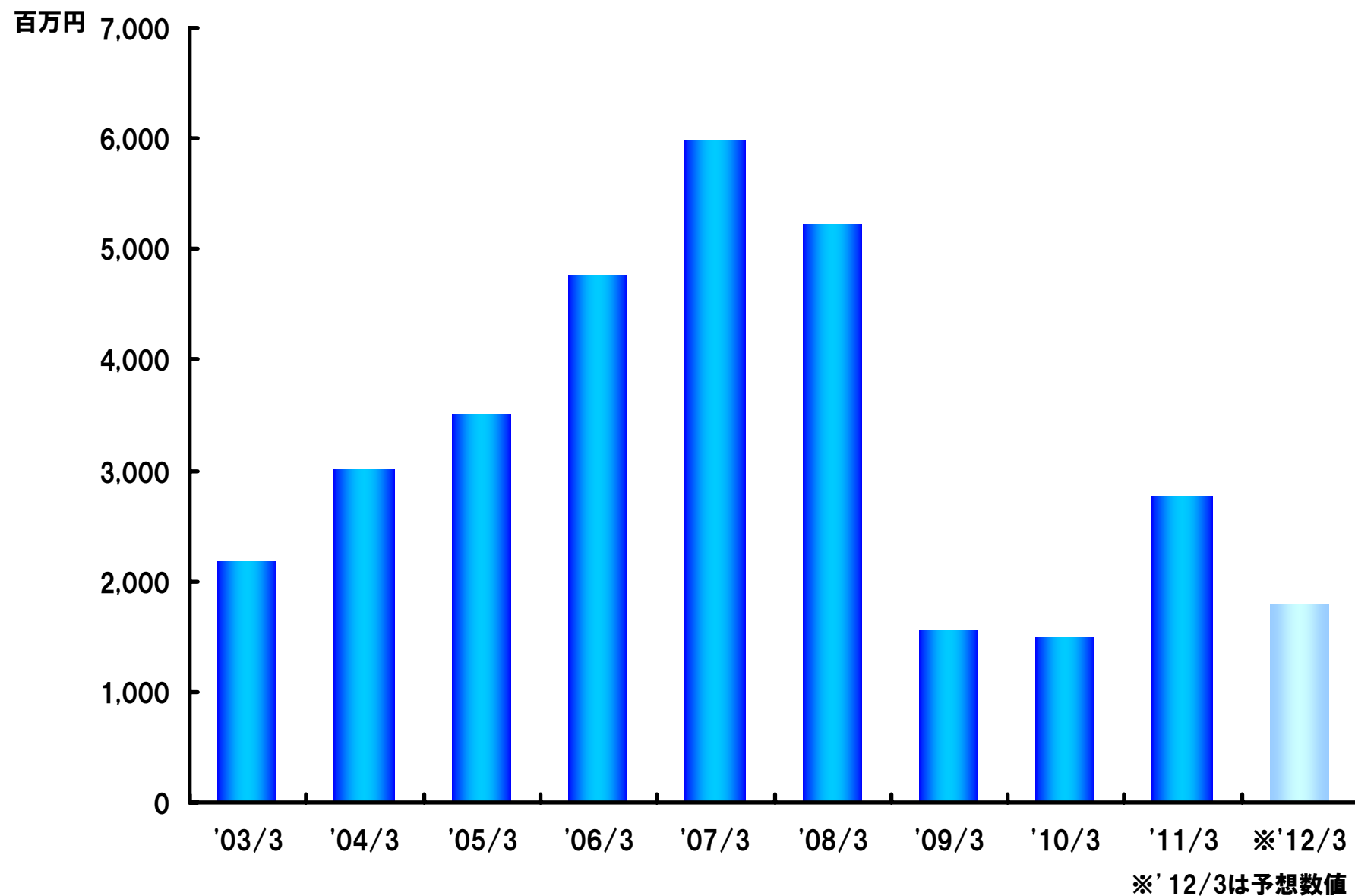


売上高(通期)

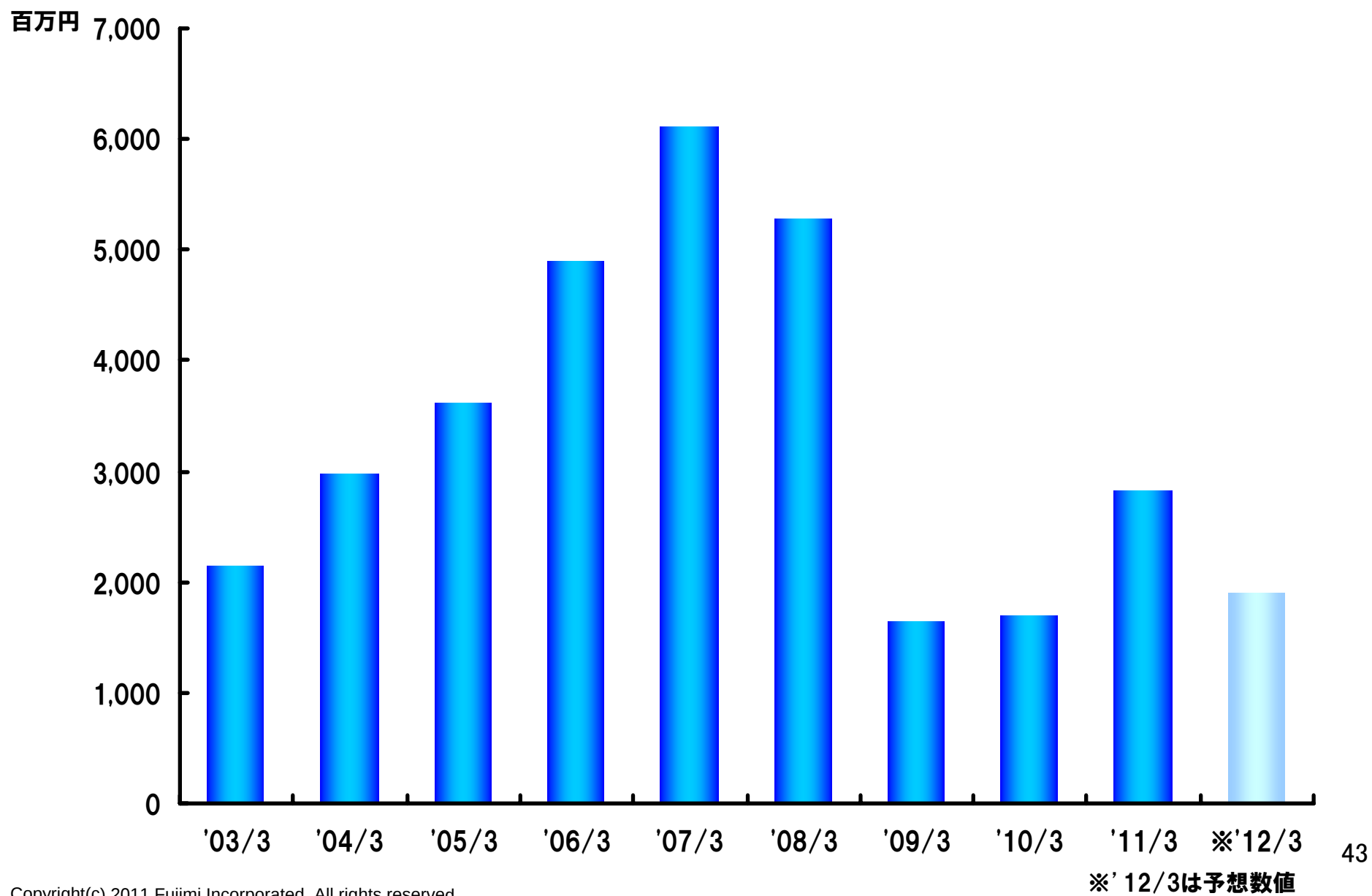


※'12/3は予想数値

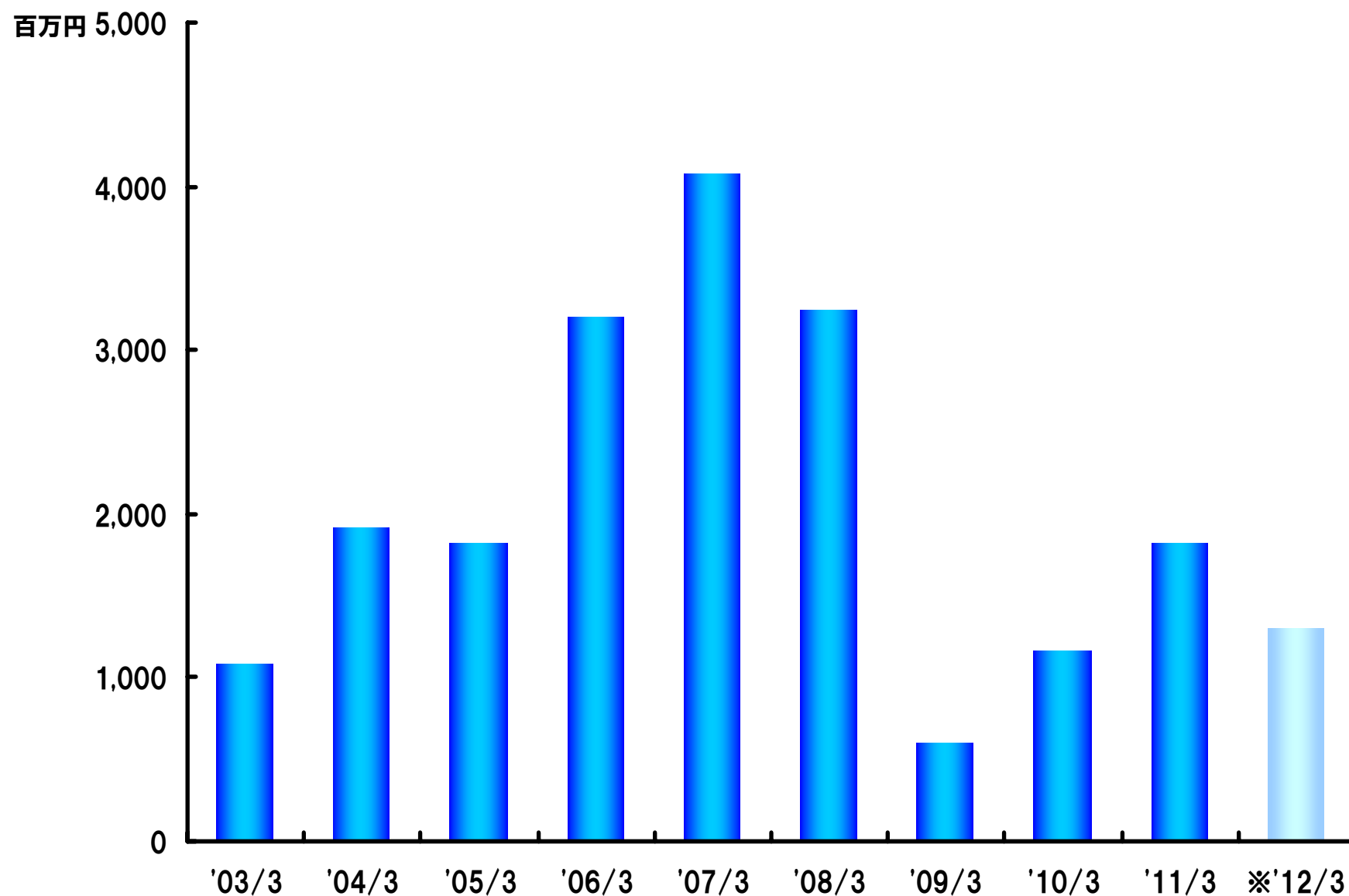
営業利益(通期)



経常利益(通期)

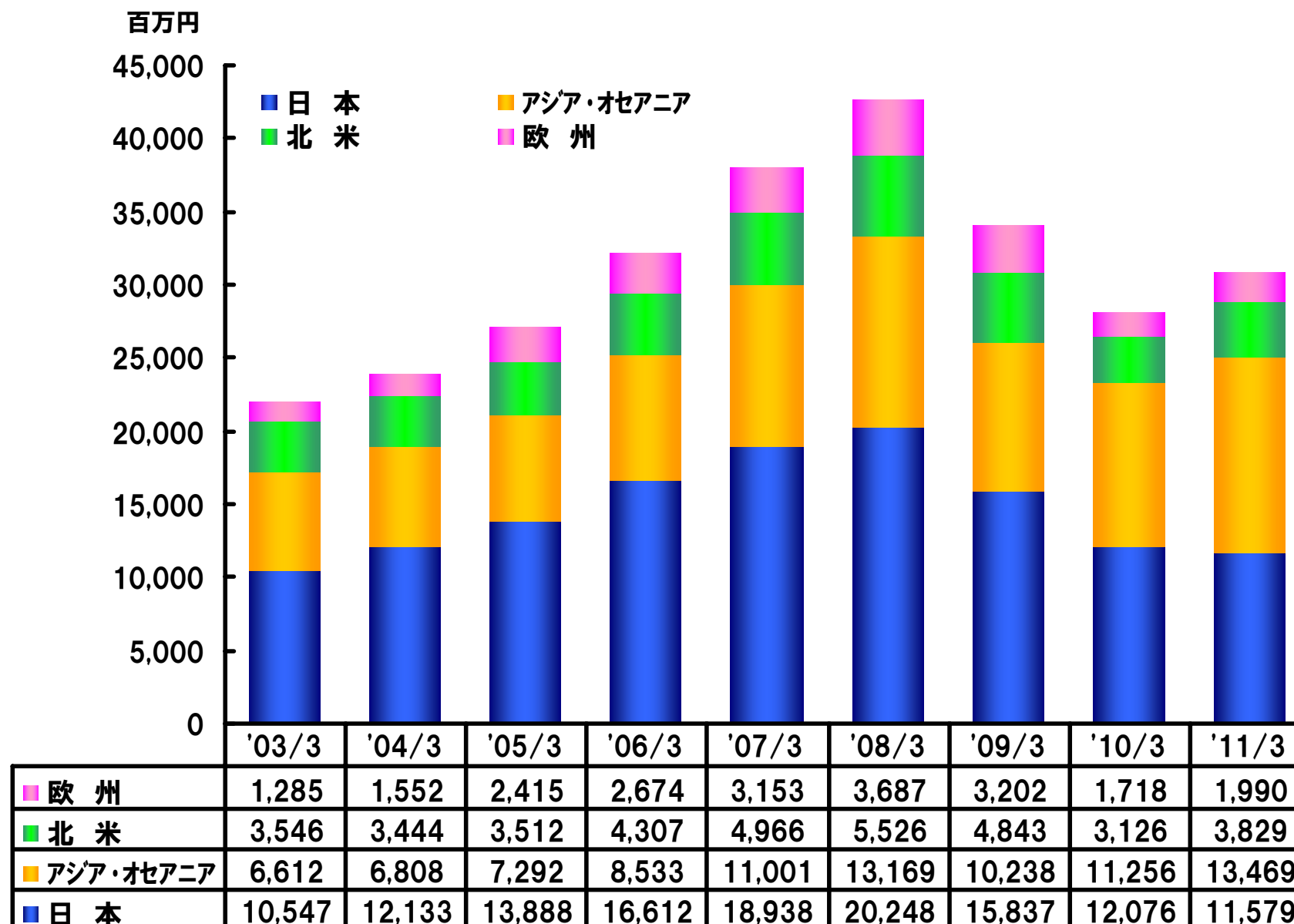


当期純利益（通期）



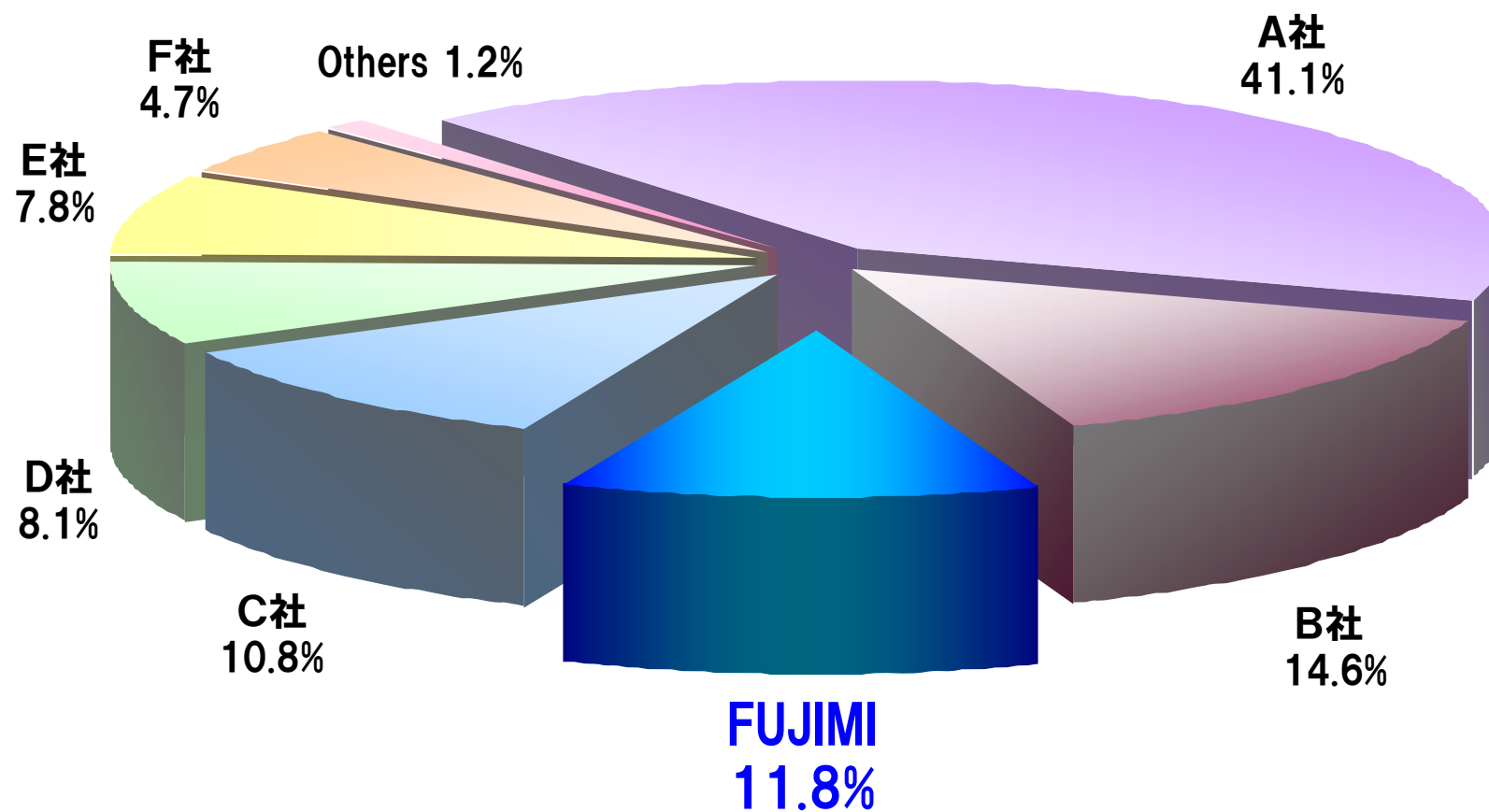
※'12/3は予想数値

地域別売上高（通期）



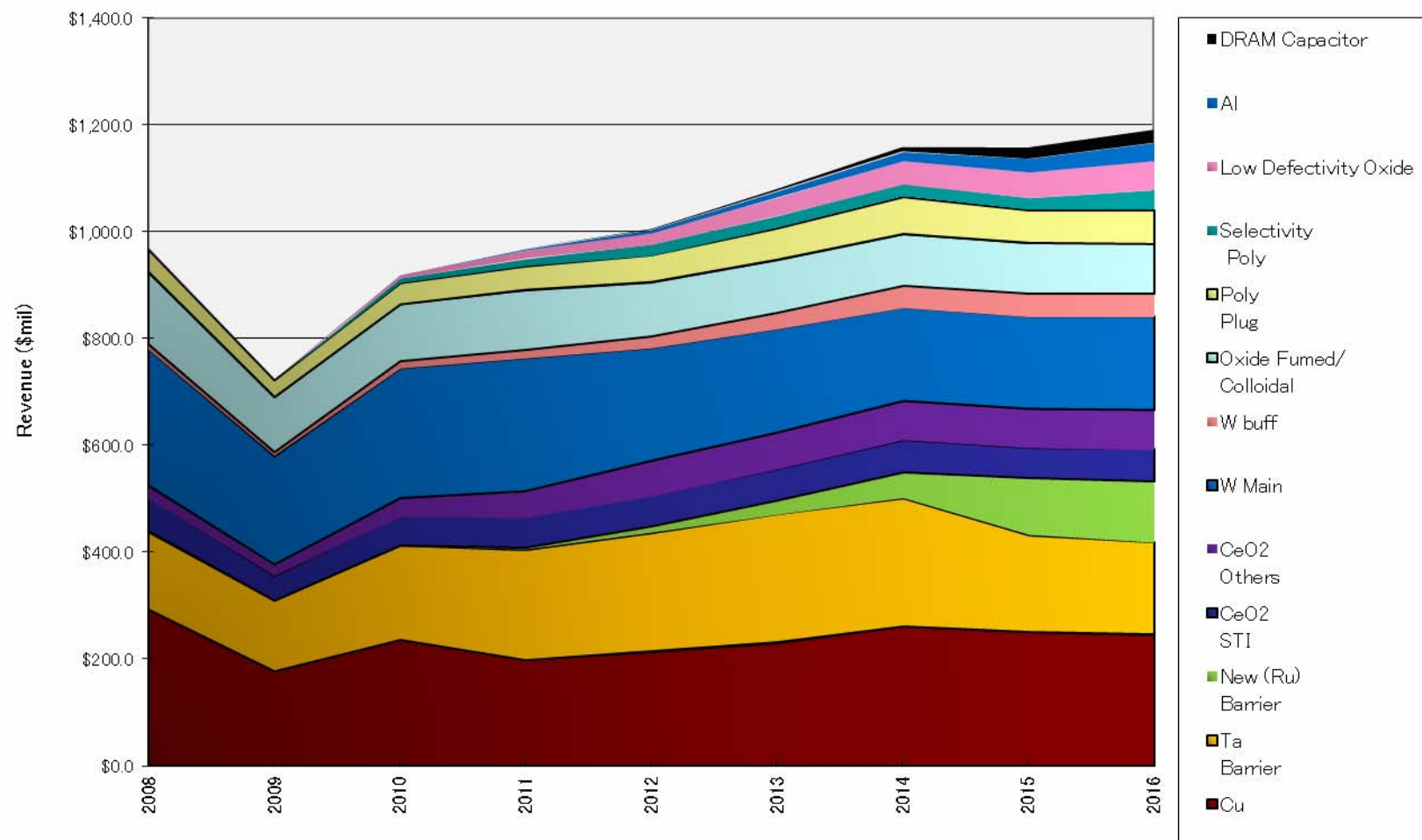
CMPスラリーマーケットシェア (Worldwide)

2011年度
(2010/4～2011/3)



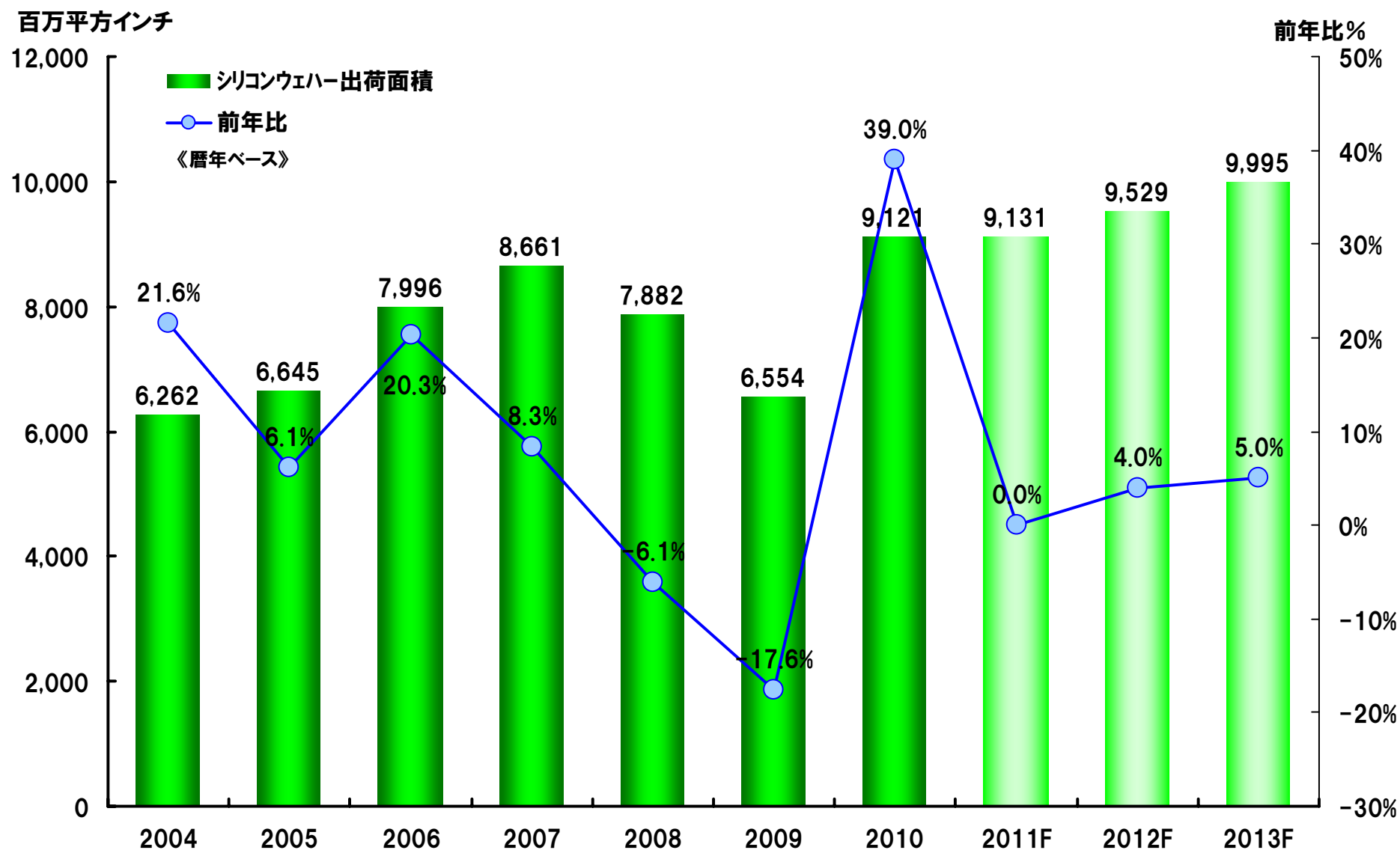
CMPスラリーマーケット (Worldwide)

2008-2016



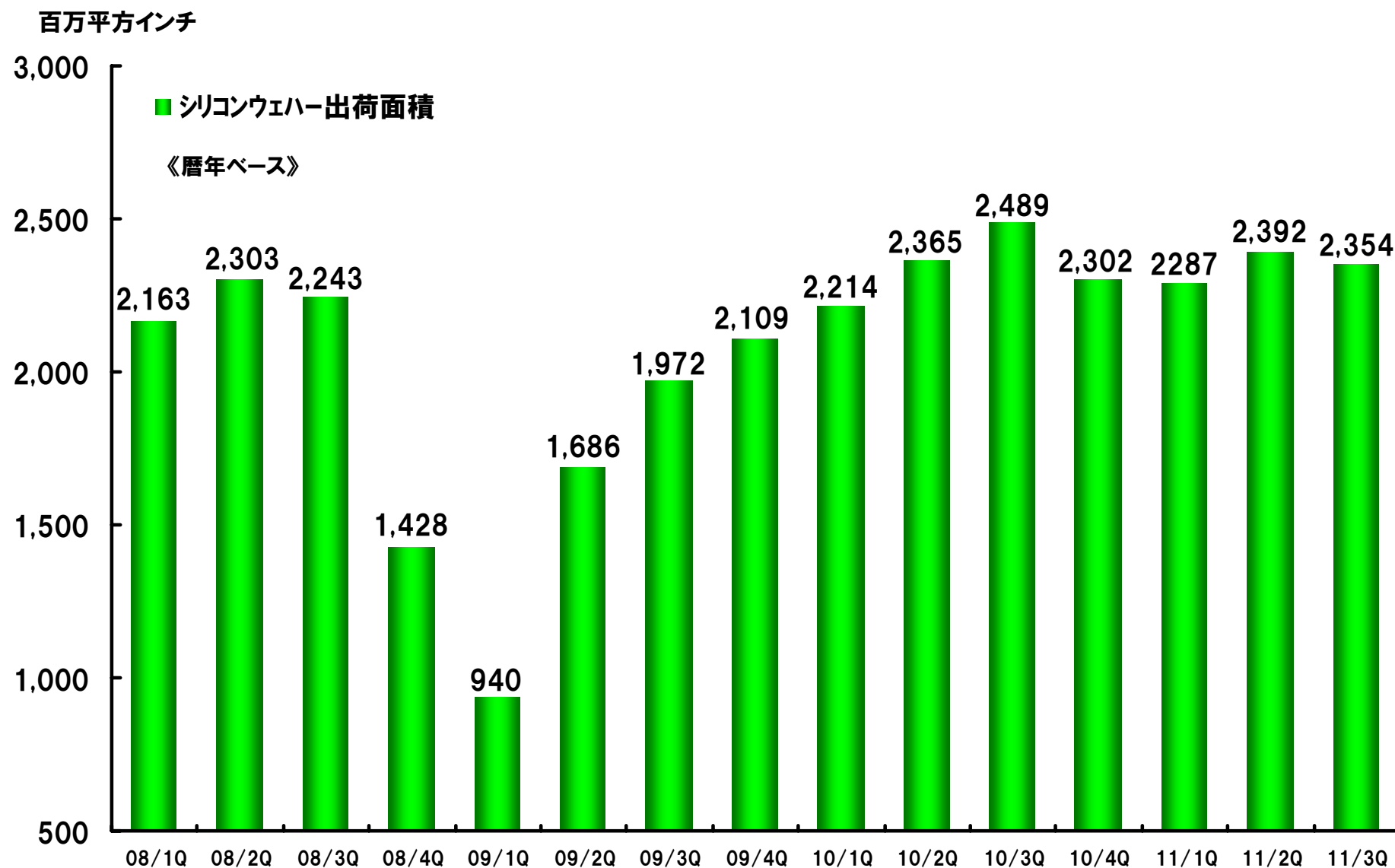
出所: 各種資料よりFUJIMI作成 2011年5月

シリコンウェハー出荷面積(年次)



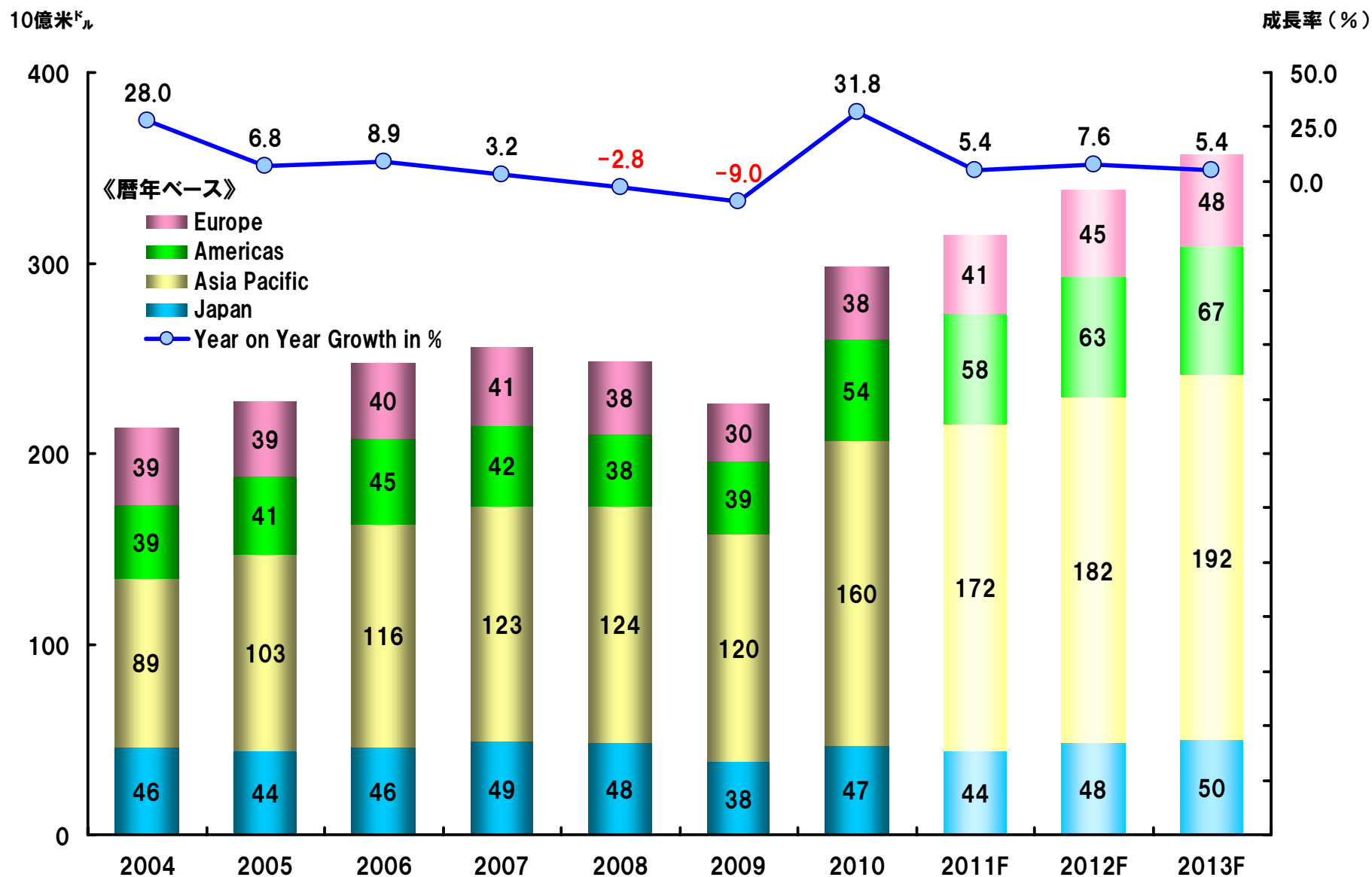
出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2011年10月 48

シリコンウェハー出荷面積(四半期)



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2011年11月 49

半導体市場規模(地域別)



Memo